

合肥新汇成微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之

补充法律意见书（一）



安徽天禾律师事务所

ANHUI TIANHE LAW OFFICE

地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层
电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450

安徽天禾律师事务所
关于合肥新汇成微电子股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市之
补充法律意见书（一）

天律意（2022）第 00099 号

致：合肥新汇成微电子股份有限公司

根据《证券法》《公司法》《注册管理办法》《编报规则第 12 号》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，汇成股份与本所签订了《聘请专项法律顾问合同》，委托本所律师以特聘专项法律顾问的身份，参加汇成股份本次发行上市工作。

本所律师已就汇成股份本次发行上市出具了《关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并上市之法律意见书》（以下简称“《法律意见书》”）及《关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并上市之律师工作报告》（以下简称“《律师工作报告》”），现根据上交所《关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（以下简称“《问询函》”）的要求，本所律师对相关情况进行了审慎核查，并出具本补充法律意见书。

除本补充法律意见书所作的补充或修改外，本所律师此前已出具的《法律意见书》《律师工作报告》的内容仍然有效。

凡经本所律师核查，发行人的相关情况与《法律意见书》《律师工作报告》披露的情况相同且本所律师的核查意见无补充或修改的，本补充法律意见书中不再详述。

除特别说明，本补充法律意见书涉及的简称与《法律意见书》《律师工作报告》中的简称具有相同含义。

为出具本补充法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明：

1、本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本补充法律意见书出具日以前汇成股份已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本补充法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本所律师同意将本补充法律意见书作为汇成股份本次公开发行股票并在科创板上市所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。

3、本所律师同意汇成股份部分或全部在招股说明书中自行引用或按上交所审核要求引用本补充法律意见书的内容，但汇成股份作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。

4、对于本补充法律意见书所涉及的财务、审计和资产评估等非法律专业事项，本所律师主要依赖于审计机构和资产评估机构出具的证明文件发表法律意见。本所在本补充法律意见书中对有关会计报表、报告中某些数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。

5、本补充法律意见书仅供汇成股份为本次公开发行股票并在科创板上市之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师根据《证券法》相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对因出具本补充法律意见书而需要提供或披露的资料、文件以及有关事实所涉及的法律问题进行了核查和验证，现出具补充法律意见如下：

一、【《问询函》问题 1】关于实控人大额负债及股权质押

根据申报材料：（1）公司控股股东扬州新瑞连及实际控制人郑瑞俊存在 3 项未到期的大额对外负债（负债本金折合 1,000 万元以上），债权金额合计 3.04 亿元，并同时为发行人未履行完毕的对外借款提供大额担保；（2）控股股东扬州新瑞连所持发行人 2000 万股股份被质押，占发行人总股本比例为 3%；（3）

根据 2018 年 10 月合肥创投与扬州新瑞连签订的《股权转让协议》，第四期股权转让款 1.1 亿元及相应的利息需在 2021 年 12 月前支付，目前尚未支付完毕。公开发行后，实际控制人郑瑞俊、杨会对发行人表决权的控制比例由 38.78% 降低至 29.09%。

请发行人说明：（1）控股股东及实际控制人对外负债的情况及形成过程、到期时间、偿还情况和后续偿还资金安排，是否具备清偿能力；（2）控股股东及实际控制人股权质押的具体情况，是否存在实现质押权的风险；（3）上述事项是否影响控制权清晰稳定，是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》关于“控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷”等发行条件，并充分提示相关风险。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查发表明确意见，并说明对公司实控人披露负债完整性的核查情况，包括核查方式、核查过程、核查结论。

【回复】

（一）控股股东及实际控制人对外负债的情况及形成过程、到期时间、偿还情况和后续偿还资金安排，是否具备清偿能力

1、控股股东及实际控制人对外负债的情况及形成过程、到期时间、偿还情况

（1）实际控制人的对外负债情况

根据发行人提供的资料并经本所律师访谈实际控制人郑瑞俊，公司所处行业为资金密集型行业，固定资产投资规模较大，公司实际控制人郑瑞俊为支持公司发展资金需求较大，存在以个人名义对外借款的情形。截至 2021 年 9 月末，实际控制人相关负债具体情况如下：

单位：万元

债权人	借款本金（折合人民币）	借款利率	负债到期时间
黄明端	4,996.96	年利率 5%	2025 年 1 月
童富	2,378.67	年利率 5%	2025 年 1 月
张兆文	8,400.00	年利率 5%	2026 年 7 月
	14,639.47	年利率 5%	2026 年 9 月

合计	30,415.10	-	-
----	-----------	---	---

注：外币折合人民币按实际交易发生日的汇率计算。

除上述负债外，截至 2021 年 9 月末，实际控制人还存在因个人资金周转需要产生的对外负债，具体情况如下：

单位：万元

债权人	借款本金（折合人民币）	借款利率	负债到期时间
孙**	379.73	未约定	未约定
杨**	25.00	未约定	未约定
合计	404.73	-	-

注 1：外币折合人民币按实际交易发生日的汇率计算。

注 2：为保护个人隐私，与发行人及其业务无关联关系的自然人仅披露姓氏。

①对黄明端的负债情况、形成过程及偿还情况

根据发行人提供的资料并经本所律师访谈郑瑞俊、黄明端以及通过公开网络检索信息，黄明端为中国台湾籍自然人，现担任高鑫零售（6808.HK，旗下持有“大润发”、“欧尚”等知名连锁卖场）董事会主席、苏宁易购（002024.SZ）董事长。黄明端系两岸经贸界知名人士，个人具有对外投资的能力和意愿。黄明端及其配偶控制的 Worth Plus 于 2019 年 9 月通过增资及受让股权的形式入股汇成有限，Worth Plus 目前为持有公司 3.65% 股份的股东。

黄明端与郑瑞俊相识多年，在 Worth Plus 入股公司前，因公司持续投入规模较大，资金需求较多，郑瑞俊以个人名义向其借款用于公司及个人周转。自 2018 年 2 月起，黄明端陆续向郑瑞俊提供借款，截至本补充法律意见书出具之日，郑瑞俊向黄明端借款余额折合人民币约为 4,996.96 万元。根据双方约定，借款期限至 2025 年 1 月 1 日止，年利率 5%，到期一次性还本付息。

②对童富的负债情况、形成过程及偿还情况

根据发行人提供的资料并经本所律师访谈郑瑞俊、童富，童富为中国台湾籍自然人，因在中国大陆及中国台湾地区经商多年，存在一定的资金积累，具有对外投资的能力和意愿。童富及其近亲属控制的 Great Title 于 2019 年 9 月通过增资及受让股权的形式入股汇成有限，Great Title 目前为持有公司 3.74% 股份的股东。

郑瑞俊向童富借款的原因和背景与黄明端相似。自 2016 年 12 月起，童富陆

续向郑瑞俊提供借款，截至本补充法律意见书出具之日，郑瑞俊向童富借款余额折合人民币约为 2,378.67 万元。根据双方约定，借款期限至 2025 年 1 月 1 日止，年利率 5%，到期一次性还本付息。

③对张兆文的负债情况、形成过程及偿还情况

根据发行人提供的资料并经本所律师访谈郑瑞俊、张兆文，张兆文为中国台湾籍自然人，因在中国大陆及中国台湾地区经商多年，存在一定的资金积累，具有对外投资的能力和意愿。张兆文近亲属控制的 Advance 于 2020 年 3 月通过增资的形式入股汇成有限，Advance 目前为持有公司 4.19% 股份的股东。

郑瑞俊向张兆文借款的原因和背景与黄明端相似。自 2018 年 5 月起，张兆文陆续向郑瑞俊提供借款，截至本补充法律意见书出具之日，郑瑞俊向张兆文借款余额折合人民币约为 23,039.47 万元。根据双方约定，借款期限至 2026 年 7 月及 2026 年 9 月，年利率 5%，到期一次性还本付息。

④对孙**、杨**的负债情况

根据发行人提供的资料并经本所律师访谈孙**、杨**，孙**、杨**均为中国台湾籍自然人，在中国大陆及中国台湾地区经商多年，未直接或间接持有公司股份，且与公司的客户、供应商不存在关联关系。

郑瑞俊因个人资金周转需要，向孙**借入新台币用于其在中国台湾地区的家庭开支，截至 2021 年 9 月末，郑瑞俊对孙**的借款余额为 1,630.21 万新台币，折合人民币 379.73 万元。

郑瑞俊因个人资金周转需要，于 2018 年 11 月向杨**借款 50 万元，此后陆续归还部分借款，截至 2021 年 9 月末，郑瑞俊对杨**的借款余额为 25 万元。

上述借款均未约定明确的借款利率及还款期限。

(2) 控股股东的对外负债情况

截至 2021 年 6 月 30 日，控股股东扬州新瑞连其他应付款余额为 39,750.70 万元，具体构成情况如下：

其他应付款对象	其他应付款余额（万元）
---------	-------------

郑瑞俊	12,985.80
合肥创投	11,000.00
瑞成建筑	8,856.00
杨会	4,213.60
纪念	2,695.30
合计	39,750.70

上述其他应付款中，对合肥创投的其他应付款 11,000 万元系扬州新瑞连根据相关股权转让协议应向其支付的第四期股权转让款，扬州新瑞连已于 2021 年 9 月支付 12,150.00 万元，并于 2021 年 11 月支付完毕剩余款项，故截至 2021 年 9 月，扬州新瑞连应付合肥创投款项已基本支付完毕，不存在对合肥创投未披露的大额负债。

除合肥创投外，扬州新瑞连其他应付款均系与其合伙人杨会、纪念及其关联方之间的资金拆借，均为合伙人向扬州新瑞连提供的借款，不涉及未披露的对外负债。

2、控股股东及实际控制人对外负债的后续偿还资金安排及清偿能力分析

根据郑瑞俊提供的资料并经本所律师访谈实际控制人，发行人实际控制人郑瑞俊从事企业经营时间较长，有一定的经营积累及融资能力，资信状况良好。郑瑞俊、杨会夫妇现持有众多投资资产，可以通过资产处置变现、所投资公司分红以及借助相关资产进行融资等多种方式进行资金筹措，偿债能力较强。

截至本补充法律意见书出具之日，除发行人及持有发行人股份的主体外，郑瑞俊、杨会夫妇主要对外投资情况如下：

出资人	被投资企业名称	出资总额/注册资本 (万元)	持股比例
郑瑞俊	瑞成建筑	700 万美元	80.00%
	百瑞发投资股份有限公司（以下简称“百瑞发投资”）	700 万新台币	99.86%
	天虹科技股份有限公司（以下简称“天虹科技”）	54,477.26 万新台币	直接持股：7.91% 通过百瑞发投资间接持股：7.13%
杨会	苏州邦盛聚泽创业投资企业（有限合伙）（以下简称“邦盛聚泽”）	5,880 万元	9.98%
	南京邦盛聚沅创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“邦盛聚沅”）	8,100 万元	37.04%

上述主要投资企业的具体情况如下：

（1）瑞成建筑

瑞成建筑系郑瑞俊实际控制的企业，主要从事建筑工程承包业务，承建了众多工业、住宅、商业地产项目。

瑞成建筑 2020 年度及 2021 年 1-9 月的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2021.9.30/2021 年 1-9 月	2020.12.31/2020 年度
总资产	15,228.72	14,943.82
净资产	7,362.18	7,135.26
营业收入	5,782.49	15,185.26
净利润	226.92	442.29

注：2020 年度财务数据经安徽中安会计师事务所审计，2021 年 1-9 月未经审计。

根据瑞成建筑提供的资料及其出具的说明，瑞成建筑在近三年内持续盈利，资产状况及现金流良好，现持有位于上海漕河泾开发区超过 1,000 m²的物业。

（2）百瑞发投资、天虹科技

根据百瑞发投资提供的资料、天虹科技出具的书面证明，截至本补充法律意见书出具之日，郑瑞俊直接持有天虹科技 7.91% 的股权，通过其实际控制的百瑞发投资间接持有天虹科技 7.13% 的股权，合计直接及间接持有天虹科技 15.04% 的股权。

根据天虹科技出具的说明并经本所律师对其相关负责人的访谈，天虹科技是一家专业集成电路设备制造商，系台积电、联电等知名晶圆厂及封测企业的设备供应商，天虹科技正在实施台湾证券交易市场上市计划，若未来成功上市，郑瑞俊所持股权将大幅增值。

（3）邦盛聚泽、邦盛聚沣

邦盛聚泽、邦盛聚沣（以下合称“邦盛系基金”）均为南京邦盛投资管理有限公司及其关联方（以下简称“邦盛资本”）实际控制和管理的私募基金。截至本补充法律意见书出具之日，杨会对邦盛系基金投资金额合计为 3,586.9 万元，已获得收益分配金额超过 2,000 万元。邦盛系基金已有剑桥科技（603083）、越

博动力（300742）、鼎胜新材（603876）、商络电子（300975）四个投资项目完成上市，另有苏州海光芯创光电科技股份有限公司、浩德科技股份有限公司等多个投资项目，相关项目通过上市等途径退出后，预计未来邦盛系基金可向杨会分配较高的投资收益。

除上述持有资产外，郑瑞俊、杨会夫妇另持有位于上海等地多套不动产（含别墅）及一定金额的理财产品等金融资产，且具有一定的融资能力，还款来源较为充足，具备清偿债务的能力。同时，若公司成功上市，实际控制人可通过多种方式筹措资金，融资手段更加多样化。

经核查，本所律师认为，公司实际控制人郑瑞俊、杨会夫妇资信状况良好，持有众多资产，还款资金来源较为充足，具备清偿债务的能力。

（二）控股股东及实际控制人股权质押的具体情况，是否存在实现质押权的风险

1、发行人控股股东及实际控制人股权质押的具体情况

根据发行人提供的资料并经本所律师核查，报告期内，发行人控股股东所持发行人股份曾存在质押情形，相关质押系为发行人获得银行贷款所提供的增信措施，具体情况如下：

（1）扬州新瑞连所持发行人 800 万股之股份质押的形成过程

2017年8月22日，发行人与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行（以下简称“建设银行龙门支行”）签署《固定资产借款合同》，约定发行人向建设银行龙门支行借款人民币6,800万元用于固定资产投资，借款期限为6年，自2017年9月19日起至2023年9月18日。

合肥鑫城国有资产经营有限公司（以下简称“合肥鑫城”）为上述借款的偿还提供连带责任保证，并于同日与建设银行龙门支行签署《保证合同》，扬州新瑞连以其持有的汇成有限6,850万元出资额为合肥鑫城上述保证提供质押反担保。

2017年8月29日，扬州新瑞连就上述股权质押事项办理股权出质登记。

2021年7月，经与合肥鑫城协商一致，扬州新瑞连解除上述股份质押登记，

并重新与合肥鑫城签署《反担保保证合同》，扬州新瑞连以其持有的发行人 800 万股股份为合肥鑫城上述保证提供质押反担保。

2021 年 7 月 29 日，扬州新瑞连就上述股份质押事项办理股份出质登记。

（2）扬州新瑞连所持发行人 1,200 万股之股份质押的形成过程

2018 年 8 月 28 日，发行人与建设银行龙门支行签署《固定资产借款合同》，约定发行人向建设银行龙门支行借款人民币 8,200 万元用于固定资产投资，借款期限为 60 个月，自 2018 年 9 月 29 日至 2023 年 9 月 18 日。合肥鑫城为上述借款的偿还提供连带责任保证，并于同日与建设银行龙门支行签署《保证合同》，扬州新瑞连以其持有的汇成有限 10,560 万元出资额为合肥鑫城上述保证提供质押反担保。

2018 年 9 月 25 日，扬州新瑞连就上述股权质押事项办理股权出质登记。

2021 年 7 月，经与合肥鑫城协商一致，扬州新瑞连解除上述股份质押登记，并重新与合肥鑫城签署《反担保保证合同》，扬州新瑞连以其持有的发行人 1,200 万股股份为合肥鑫城上述保证提供质押反担保。

2021 年 7 月 29 日，扬州新瑞连就上述股份质押事项办理股份出质登记。

2、上述股权质押的解除情况

根据发行人提供的《股权出质注销登记通知书》并经本所律师核查，上述股份质押已于 2021 年 12 月 21 日全部解除。

截至本补充法律意见书出具之日，发行人控股股东、实际控制人所持发行人股份不存在质押情形，亦不存在实现质押权的风险。

（三）上述事项是否影响控制权清晰稳定，是否符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》关于“控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷”等发行条件，并充分提示相关风险

经核查，截至本补充法律意见书出具之日，控股股东扬州新瑞连股份质押已全部解除，发行人控股股东、实际控制人所持股份权属清晰，不存在质押情形。

实际控制人郑瑞俊从事企业经营时间较长，有一定的经营积累及融资能力，财务状况良好。郑瑞俊、杨会夫妇现持有众多投资资产，可以通过资产处置变现、所投资公司分红以及借助相关资产进行融资等多种方式进行资金筹措，还款资金来源较为充足，具备清偿债务的能力，预计债务到期后因实际控制人无法清偿债务导致公司控制权变更的可能性较小。

经核查，本所律师认为，扬州新瑞连股份质押已全部解除，实际控制人具备清偿债务的能力，其所持公司股份权属清晰，不存在重大权属纠纷，债务到期后因实际控制人无法清偿债务导致公司控制权变更的可能性较小，发行人符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》关于“控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷”等发行条件。

公司已在招股说明书“重大事项提示”之“二、实际控制人借款金额较大，存在影响公司实际控制人稳定性的风险”中充分提示相关风险。

（四）核查情况

1、核查过程

针对上述事项，本所律师履行了如下核查程序：

（1）对实际控制人及其控制的企业进行资金流水核查；

（2）对实际控制人对外负债涉及的相关自然人进行访谈，取得其出具的书面确认文件，查阅实际控制人对外负债相关的合同、借款及还款凭证，核查实际控制人对外负债的形成过程、到期时间及偿还情况；

（3）取得并查阅中国人民银行征信中心出具的信用报告及控股股东、实际控制人出具的书面确认，检索中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国等网络公示信息，核查控股股东及实际控制人的资信状况，核查其是否存在失信记录、重大诉讼或仲裁，所持公司股份是否存在诉讼或司法冻结等情形；

（4）查阅控股股东扬州新瑞连审计报告及其他应付款明细账，核查控股股东对外负债情况；

（5）查阅实际控制人出具的调查表及境外律师出具的法律意见书，并通过国家企业信用信息公示系统、企查查等网站进行网络检索，核查实际控制人投资资产情况；

（6）查阅瑞成建筑审计报告及财务报表，对天虹科技、邦盛资本相关负责人进行访谈，核查实际控制人投资资产的情况；

（7）对实际控制人进行访谈，了解其对外负债的后续偿还资金安排及还款资金来源，核查其是否具备清偿能力；

（8）查阅发行人工商档案，检索国家企业信用信息公示系统等网络公示信息，核查控股股东股份质押的具体情况；

（9）查阅实际控制人出具的调查表及股权确认函，对实际控制人进行访谈，了解控股股东股份质押的原因及背景；

（10）查阅发行人与建设银行龙门支行签订的贷款合同、合肥鑫城与建设银行龙门支行签订的连带保证合同及扬州新瑞连与合肥鑫城就股份质押事项签署的相关协议；通过国家企业信用信息公示系统、企查查等网络平台查询合肥鑫城的基本情况；

（11）查阅《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等相关法规，分析发行人控股股东股份质押、实际控制人对外负债事项是否影响发行人控制权清晰稳定。

2、核查意见

经核查，本所律师认为：

（1）控股股东及实际控制人对外负债形成原因及过程合理，相关负债尚未到期，未偿还完毕。

（2）实际控制人资信状况良好，持有众多投资资产，可通过资产变现、上市后公司分红及其他外部融资方式筹措资金，还款资金来源较为充足，具备清偿债务的能力。

（3）发行人控股股东所持发行人股份质押已全部解除，不存在实现质押权

的风险。

（4）发行人符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》关于“控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷”等发行条件，并已在招股说明书中充分提示相关风险。

（五）针对公司实际控制人披露负债完整性的核查情况

1、核查过程

针对公司实际控制人披露负债完整性，本所律师履行了以下核查程序：

（1）资金流水核查

①本所律师于2021年4月至2021年9月期间陪同核查对象前往四大国有银行、主要股份制银行及地方商业银行等银行网点，对于银行柜台或自助柜员机可以调取个人名下账户清单的，调取账户清单并根据清单相应打印自报告期初起载明交易对方完整信息的全部银行流水；银行柜台或自助柜员机无法调取账户清单的，由核查对象自行提供银行卡或账号打印银行流水；部分账号已注销的，由银行开具注销证明并打印注销前的银行流水；若无法开具注销证明或无查询结果的，由本所律师陪同核查对象向银行柜员确认并记录。

②涉及境外银行账户的，由本所律师与相关银行工作人员视频沟通确认核查对象的开户情况，并由银行工作人员将核查对象自报告期初起的完整电子版银行流水通过工作邮箱发送至本所律师邮箱；部分银行工作人员无法配合视频确认及发送电子版银行流水的，由核查对象自行提供，并通过闭环测试等方式验证完整性及真实性。

③取得首批银行流水后，对核查对象的银行流水进行交叉复核，发现并记录核查对象尚未提供的其他银行卡号，从而扩大核查范围，尽可能确保核查完整性。如发现核查对象与其本人或其他核查对象尚未提供的其他账户发生往来的，要求该等核查对象补充提供银行流水。

④取得核查对象出具的关于提供资金流水完整性的承诺，确认其已完整提供报告期内曾存续或控制的银行账户资金流水。

⑤针对调取的资金流水中单笔金额或单日累计金额大于5万元的交易，逐笔了解交易性质、交易对方背景，并摘录形成记录。针对上述大额交易，本所律师取得相应的资产购置协议、借款协议、借还款凭证等相关交易凭证，并对涉及的相关人员进行访谈确认。

基于上述核查程序，本所律师取得并查阅实际控制人郑瑞俊、杨会报告期内银行流水的具体情况如下表所示：

核查对象	核查账户数量	流水覆盖期间	取得资金流水是否完备
郑瑞俊	18	2018.01-2021.09	是
杨会	14	2018.01-2021.09	是

截至2021年9月末，实际控制人对外负债及享有的债权情况如下：

单位：万元

类别	债权人/债务人	主债权金额	是否存在担保
实际控制人对外负债	张兆文	23,039.47	否
	黄明端	4,996.96	否
	童富	2,378.67	否
	孙**	379.73	否
	杨**	25.00	否
	合计	30,819.83	-
实际控制人对外债权	杨**	1,100.00	-
	林文浩	150.00	-
	张**	94.00	-
	郑**	65.88	-
	林**	63.04	-
	合计	1,472.92	-
实际控制人对外负债与对外债权差额		29,346.91	-

注1：外币折合人民币按实际交易发生日的汇率计算。

注2：为保护个人隐私，与发行人及其业务无关联关系的自然人仅披露姓氏

实际控制人对外负债情况详见本补充法律意见书问题1“（一）控股股东及实际控制人对外负债的情况及形成过程、到期时间、偿还情况和后续偿还资金安排，是否具备清偿能力”部分。

根据本所律师对相关自然人的访谈，杨**系安徽**公司的实际控制人，其因公司资金周转向郑瑞俊借款，该等借款与发行人及其业务无关，且已于2021年11月全部归还；林文浩系发行人副总经理，其因个人购房的资金需求向郑瑞俊

借款；张**、郑**、林**均为郑瑞俊的亲友，因个人资金周转向其借款，该等借款与发行人及其业务无关。

（2）查阅信用报告

取得并查阅中国人民银行征信中心出具的扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会的信用报告，经核查前述主体报告期内不存在其他未披露的大额负债。

（3）网络核查

经本所律师在检索中国裁判文书网、中国执行信息公开网、信用中国等网络公示信息，扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会不存在失信记录、重大诉讼或仲裁，所持公司股份不存在诉讼或司法冻结等情形。

2、核查意见

发行人实际控制人已完整披露其对外负债情况，实际控制人除已披露的负债外，不存在其他未披露的负债。

二、【《问询函》问题 2.1】关于核心技术来源

根据申报材料：（1）发行人核心技术人员共 4 名。均曾在硕邦科技下属子公司任职，硕邦科技为市场第一大显示驱动芯片封测企业；（2）江苏汇成于 2016 年 7 月成为发行人全资子公司。

2011 年成立时江苏汇成具体技术研发、生产经营等事项由中国台湾籍管理团队负责。汇成股份依托江苏汇成前期资源迅速发展，目前可以针对 8 吋及 12 吋晶圆提供显示驱动芯片的金凸块制造、封装测试服务。请发行人说明：（1）发行人核心技术的来源和形成发展过程，设立短期内公司业务发展较快的原因，发行人与江苏汇成在业务、技术、人员方面的关系及发展过程，未将江苏汇成作为上市主体的原因；（2）核心研发团队构成情况及背景，核心技术人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，发行人核心技术、产品的研发是否涉及其原任职单位的技术成果，是否存在纠纷及潜在诉讼风险。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

【回复】

（一）发行人核心技术的来源和形成发展过程，设立短期内公司业务快速发展较快的原因，发行人与江苏汇成在业务、技术、人员方面的关系及发展过程，未将江苏汇成作为上市主体的原因

1、发行人核心技术的来源和形成发展过程

根据发行人提供的核心技术清单、专利清单及其出具的说明，并经本所律师访谈公司核心技术人员、查询同行业可比公司公开披露信息，公司核心技术主要集中在金凸块制造（Gold Bumping）、晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）等工艺制程，其中 COG 与 COF 均属于倒装芯片封装技术（Flip Chip）。凸块制造技术与倒装芯片封装技术起源于 IBM 初代凸块制造工艺，目前显示驱动芯片封测同行业公司均在原有底层工艺上进行各个环节的工艺创新，以满足晶圆大尺寸化、芯片封测凸点高密度细间距化的行业发展趋势。



（1）Bumping 与 Flip Chip 技术起源与发展

凸块制造技术（Bumping）与倒装芯片封装技术（Flip Chip）起源于 20 世纪 60 年代。彼时，IBM 开发了倒装芯片封装技术，其封装方式为芯片正面朝下向基板，无需引线键合，形成最短电路，降低电阻，最早是应用在陶瓷基板上的固态逻辑电路。IBM 公司为实现倒装芯片封装技术开发出初代凸块制造工艺，其通过高铅焊料蒸镀工艺进行凸块加工，使用高温/低温共烧陶瓷载板（基板）进行互联，受该工艺方案限制，当时凸块间距较大（>250μm）、焊接温度过高（>300℃），且生产成本高居不下，极大限制了凸块技术的推广和应用。

2000 年左右，随着半导体行业技术的发展，新的凸块制造工艺打破了初代工艺的困局，溅射凸块底部金属工艺和电镀锡凸块工艺取代了原先成本高昂的蒸镀技术方案，并将凸块间距进一步缩小至 200μm 以下。得益于凸块制造工艺与

基板技术的发展，倒装工艺在提升了凸块密度、I/O（输入/输出）数量的同时，生产成本大幅降低，至此倒装芯片技术开始广泛应用。

2000 年左右至今，凸块制造与倒装芯片封装的应用技术一直随着集成电路行业技术发展而演进，显示面板的兴起带动了显示驱动芯片的发展，进而促进了 Bumping 与 Flip Chip 的技术进步与产业化应用，为适应显示面板封装需求 Flip Chip 衍生出 COG、COF 等细分封装形式。随着集成电路晶圆制程技术从 2000 年左右的 300nm 发展到目前的 7nm 左右，晶圆尺寸逐渐增大至如今的 8 吋、12 吋，倒装封装难度大幅提高，凸块间距也发展到 100 μ m 以下的极细间距，单芯片上的金属凸块超过 1,500 个，需要每个凸块都同基板上的线路形成良好电气接触。晶圆大尺寸化、芯片封测凸块高密度细间距化的行业发展趋势对封测企业的凸块制造与倒装封装技术提出了极高要求，同行业公司均在原有 Bumping 与 Flip Chip 底层工艺上进行各个环节的工艺创新，以满足客户及终端应用发展的需求。

（2）公司核心技术来源及形成发展

显示驱动芯片封测是资本密集型与技术密集型行业，封测技术研发主要由客户需求驱动，对生产流程与生产装置不断优化，以保持技术指标先进性、不断突破生产良率极限，需企业长期持续投入资金进行优化创新。自成立以来，公司核心技术所涉及的相关专利均系公司及子公司自主研发，不涉及核心技术受让或专利授权等情形。

①公司核心技术来源及发展脉络

公司核心技术的发展来源于资本投入与技术人员的协同：公司通过资本投入一方面购进先进设备，为生产与研发提供优质平台；另一方面不断引进专业技术人员优化公司封装技术，并通过持续研发过程沉淀下来，逐渐形成公司核心技术，在此过程中公司逐渐完善人才培养制度、形成自身的研发技术团队。

在技术研发过程中，由于金凸块制造制程稳定量产是导入客户最关键的技术，受限于资金限制，公司发展前期优先发展金凸制造技术，兼顾发展晶圆测试与后段封装制程技术，具体情况如下：

2011 年，为抓住面板制造产业链向中国大陆转移的发展机遇，一批中国台

湾显示驱动芯片封测领域的专业技术人才来到中国大陆，与童剑峰、郑瑞俊、杨绍校等投资者达成合作，共同设立江苏汇成。童剑峰出任江苏汇成的董事长，总体负责经营管理事项；中国台湾的技术与管理团队负责具体技术研发、生产经营等事项，并开始自主研发 8 吋晶圆金凸块制造技术与倒装芯片封装技术。

2011 年至 2014 年，江苏汇成陆续投入大量资金建设封测厂房，购入设备建设生产线与研发平台，并持续引入中国台湾的专业技术人员，攻克可稳定并规模化封测显示驱动芯片的技术难关，培养公司自身的研发团队，逐渐研发出驱动芯片可靠性工艺、微间距驱动芯片凸块制造技术、高稳定性晶圆切割技术与高精度柔性基板封装工艺中微尘防护技术等多项核心技术，并于 2014 年实现 8 吋金凸块制造制程稳定量产、月产能达 8 千片，后段制程亦逐步实现量产。

2015 年，为迎合显示驱动芯片大尺寸晶圆封装的发展趋势，汇成有限在合肥设立以布局 12 吋晶圆封测服务。

2015 年至 2018 年，公司依靠江苏汇成已有的核心技术与持续引入的专业技术人才，投入大量资本，积极研发 12 吋晶圆金凸块制造技术与倒装芯片封装技术，同时不断优化已有核心技术。在这期间，公司逐步完成 12 吋晶圆封测基地建设，打造出一支经验丰富、结构合理、优势互补的研发团队，技术研发方面开发出凸块高可靠性结构及工艺、高精度晶圆研磨薄化技术与高精度高效内引脚接合工艺等核心技术，并具备 12 吋晶圆金凸块制程量产能力，合肥封测基地逐步导入业内知名芯片设计公司；公司已有核心技术得到较大优化，2018 年各制程生产良率稳定在 99.90% 以上。

2018 年至 2021 年，公司根据客户需求不断创新和优化生产流程与生产装置，在原有核心技术基础上持续投入人员和资金进行研发，以保持技术指标先进性、不断突破生产良率极限，2021 年以来部分制程生产良率稳定在 99.99%。同时，公司基于已有技术逐步将研发领域拓展至 CMOS 图像传感器封装测试领域，截至目前已具备一定技术积累。

②公司核心技术发展现状及方向

公司通过与客户沟通交流及市场调研，综合判断客户需求，进而进行针对性的自主研发。在显示驱动芯片封装测试领域，公司通过长期的研发投入及技术积

累，以工匠精神持续研发新技术、优化现有技术，积极布局大尺寸晶圆、高密度细间距凸点封装技术，掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术，广泛应用于公司提供的封测服务中，并涵盖了封测服务的整个工艺流程。

公司核心技术具体形成发展过程及现状如下：

序号	核心技术名称	来源	形成发展过程
1	驱动芯片可靠性工艺	自主研发	<p>由于 LCD 驱动芯片工艺制作成本较高，压合面板损坏后返工难度较大等，芯片封装的可靠性直接影响到终端产品性能与市场份额。</p> <p>基于以上背景，公司自 2011 年开始持续研发、优化驱动芯片封装的可靠性工艺：一方面，公司通过优化凸块及封装结构，开发新型电浆设备等方式，提高驱动芯片封装的可靠性；另一方面，公司在封装结构上开发多段式凸块结构及封装结构，并通过改善的电浆装置，利用氮气电浆降低凸块阻障层的金属钛或钛钨氧化成氧化钛，以达到提高驱动芯片封装可靠度的目的。</p> <p>基于研发成果，公司目前取得 5 项相关专利。</p>
2	微间距驱动芯片凸块制造技术	自主研发	<p>液晶显示屏的分辨率和性能不断提高，使得驱动芯片的封装技术趋向微细化，减小凸块间距可提升后续封装制程空间，达到提高芯片封装性能和降低封装尺寸的目的。</p> <p>公司于 2011 年开始研发微间距驱动芯片凸块制造工艺。通过不断地优化凸块排布设计，研发优化光阻涂胶、电镀、蚀刻等设备装置和工艺流程，逐渐形成了微间距驱动芯片凸块制造技术。</p> <p>基于研发成果，公司目前取得 11 项相关专利。</p>
3	凸块高可靠性结构及工艺	自主研发	<p>芯片凸块制造工艺中的湿法蚀刻因各向同性和过量蚀刻等因素，会形成对芯片凸块可靠性有影响的底切结构。</p> <p>为解决上述问题，公司于 2015 年开始研发可减小或消除凸块底切结构的设备及工艺，提高芯片凸块结构的可靠性。公司通过改善电镀工艺、湿法蚀刻工艺的设备装置以及研发新型凸块结构工艺，优化凸块粗糙度，增加蚀刻保护层，从而减少或消除凸块的底切结构，提高凸块可靠性。</p> <p>基于研发成果，公司目前取得 7 项相关专利。</p>
4	高精度晶圆研磨薄化技术	自主研发	<p>传统的晶圆研磨切割制程中，芯片晶背粗糙度较大、芯片应力脆化及芯片不完整等问题均会造成芯片内部功能失效，导致面板显示异常。</p> <p>为攻克上述行业难题，公司自 2014 年起就晶圆研磨制程工艺及相关辅助治具，进行深入研究，最终研发出一种高应力覆晶封装晶圆研磨工艺，从而减少了封装过程中驱动芯片应力断裂、晶背粗糙及芯片不完整，导致的芯片电讯号传输异常等问题的发生，提高了产品的可靠性。</p> <p>基于研发成果，公司目前取得 14 项专利。</p>
5	高稳定性晶圆切割技术	自主研发	<p>根据液晶面板市场产品逐渐轻薄化、大尺寸及高分辨率等发展趋势，公司自 2012 年起对细长型、超薄型晶粒的高速稳定切割工艺进行研发，通过不断摸索和实践，成功研发出以“三面切割方法”和“真空异常的晶圆</p>

序号	核心技术名称	来源	形成发展过程
			<p>切割处理方法”等具有代表性的特殊切割工艺，攻克了行业内细长型、超薄型晶粒切割的难题，大幅提升了产出效率和产品良率，增强了公司在市场上的竞争力。</p> <p>基于研发成果，公司目前取得 10 项专利。</p>
6	高精度高效内引脚接合工艺	自主研发	<p>在 COF 制程中，键合精度的高低决定了产品的封装良率，以及终端产品运行的稳定性，行业内长期受限于间距 20 μm 以下内引脚的键合难题。</p> <p>基于上述背景，公司自 2015 年成立研发小组投入大量资金和人力，进行了一系列优化拾取键合技术的研发活动，从卷带传送、芯片的承接拾取到压合各环节进行相关机构、治具改良设计，以及工艺参数优化，目前公司的键合工艺在行业内处于顶尖水平。</p> <p>基于研发成果，公司目前取得 24 项专利。</p>
7	高精度柔性基板封装工艺中微尘防护技术	自主研发	<p>以往封装工艺对引脚接合处的外来异物防护不够，而金属类异物和含卤异物均会使产品短路失效。</p> <p>为解决上述问题，公司于 2014 年成立研发小组，持续开发引脚接合处异物防护的技术，从人员、设备、原材料、环境、制度等多重方面入手，重点收集、分析异物产生来源，对异物进行成份分析，建立数据库统计分析高风险区域，并针对性地研发异物防护和探测装置，有效提升产品良率及可靠度。</p> <p>基于研发成果，公司目前取得 8 项专利。</p>
8	晶圆清洁技术	自主研发	<p>晶圆清洗是集成电路制造工艺中最重要、最频繁的工序之一，在晶圆制造与封装过程中，表面沾染污物会严重影响芯片的性能、质量、可靠性与生产良率。随着尺寸缩小、结构复杂化，芯片对杂质含量的敏感度也相应提高。</p> <p>基于上述背景，公司自 2015 年开始投入资金，研发提高晶圆清洁度及清洁效率的洗液、工艺流程及设备。通过研发新型氧化钨洗液及生产工具提高钛钨蚀刻工艺的效率、良率及可靠性，开发晶圆清洗机、清洗装置以及清洁治具有效提高了晶圆清洗工艺的效率、良率及可靠性。</p> <p>基于研发成果，公司目前取得 4 项相关专利。</p>
9	集成电路封装微尘管理技术	自主研发	<p>随着驱动芯片封装技术趋向微型化、集成化，业内在封装驱动芯片时，普遍受柔性基板引脚和芯片凸块间的微尘粒子所困扰，其易造成芯片电性能失效。</p> <p>为解决上述问题，公司自 2013 年起将封装工艺中微尘粒子的管控纳入重点研发项目，投入了大量的人力、物力与时间研究解决方案，成功研发了从凸块制造到 COF 封装全流程防控微尘粒子的技术，解决了芯片因微尘粒子导致的电性能失效问题。</p> <p>基于研发成果，公司目前取得 8 项相关专利。</p>
10	晶圆高精度稳定性测试技术	自主研发	<p>由于驱动芯片特征线宽逐渐细微化，传统的晶圆测试工艺已无法满足其高精度、高稳定性测试的要求。</p> <p>基于上述背景，公司自 2012 年开始投入大量资金，重点研发微小间距芯片高精度、高稳定性的测试技术，期间历经多次试验，最终成功攻克了</p>

序号	核心技术名称	来源	形成发展过程
			晶圆状态下各项特性指标的测试技术，使得晶圆能够高效稳定的进行测试，为后段制程提供了坚实的保障。 基于研发成果，公司目前取得 10 项相关专利。

综上所述，发行人核心技术均为自主研发，来源合法合规。

2、设立短期内公司业务发展较快的原因

根据发行人出具的说明、Frost & Sullivan 出具的排名情况并经本所律师访谈公司实际控制人、主要客户，公司于 2015 年设立后，依托江苏汇成多年技术、人才、客户资源等积累，凭借 12 吋产品的先发优势、领先的技术优势、知名客户的资源优势、政府的大力支持与显示驱动芯片市场的持续增长等因素，业务迅速发展，2020 年度显示驱动芯片封装出货量在全球显示驱动芯片封测领域排名第三，在中国境内排名第一。

（1）前瞻性布局 12 吋产品的先发优势

综合技术发展趋势、经济效益与产能供应等方面考虑，显示驱动芯片设计公司对 12 吋晶圆封测需求持续上升。一方面，晶圆尺寸越大，可利用效率越高。12 吋晶圆拥有较大的使用面积，得以达到效率最佳化，相对于 8 吋晶圆而言，12 吋的可使用面积超过两倍，具有更好的成本效益。另一方面，12 吋晶圆产能供应持续增加，是晶圆制造行业未来主要的发展方向。来自 IC Insights 的统计和预测显示，2018-2021 年间，全球范围内可量产的 12 吋晶圆厂每年都会增加，到 2021 年将达到 123 家，而这一数字在 2016 年为 98 家。截至 2016 年底，12 吋晶圆贡献了全球 IC 晶圆厂产能的 63.6%，预计到 2021 年底这一数字将达到 71.2%。

在显示驱动芯片封测领域，公司前瞻性布局 12 吋晶圆封测工艺，是中国境内最早导入 12 吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备 12 吋晶圆全制程封装测试能力，随着设备投入后将进一步释放产能。

（2）领先的技术优势

江苏汇成成立于 2011 年，主要从事基于 8 吋晶圆的显示驱动芯片的金凸块制造及封装测试服务，2015 年汇成有限设立时，江苏汇成在多年的自主研发以

及生产实践过程中，已拥有了一定的技术与人才积累，积攒了丰富的生产经验。汇成有限基于江苏汇成的技术、人才和生产经验积累较快开发出 12 吋晶圆金凸块制造技术与倒装芯片封测技术，并快速实现了量产，抓住了市场机会。

公司一直高度重视研发工作，将技术、工艺创新作为核心竞争力，每年投入大量的资源开展新工艺、新技术的研发工作，陆续研发出微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。公司根据行业发展趋势与客户需求持续优化已有技术、创新新技术，以保持公司技术的先进性。

（3）知名客户的资源优势

汇成股份基于江苏汇成在行业内的客户资源与知名度，凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、生产一体化、持续提升的量产能力、交付及时性等，不断开拓新客户，陆续与知名的显示驱动芯片设计公司建立合作。自成立以来，公司与联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电、晶门半导体等行业内知名芯片设计公司建立了稳定的合作关系，其中公司分别于 2020 年和 2021 年上半年获得联咏科技颁发的“最佳配合供应商奖”和“最佳品质供应商奖”，公司所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板，2020 年度全球排名前五显示驱动芯片设计公司中三家系公司主要客户，2020 年度中国排名前十显示驱动芯片设计公司中九家系公司主要客户，深厚的客户资源将为公司的长期发展带来源源动力。

（4）政府大力打造集成电路产业集群，助推公司快速发展

安徽省、合肥市聚焦“芯屏器合”的产业发展方向，安徽省各级政府积极整合相关产业、创新、人才、资本等资源，引导区外企业的入驻和聚集，大力推进集成电路产业的集群发展，着力打造以合肥为核心的“一核一弧”的集成电路产业空间分布格局。

公司通过合肥市政府招商引资落户合肥市综合保税区，当地政府为公司提供有力的政策支持。2018 年 2 月，安徽省政府办公厅发布《安徽省半导体产业发展规划（2018-2021 年）》，明确表示要依托长电科技、通富微电、新汇成（指

发行人）等企业，大力发展凸块（Bumping）、倒装（Flip Chip）、晶圆级封装（WL-CSP）、硅通孔（TSV）等先进封装技术，支持建设先进封装测试生产线和封装测试技术研发中心。

（5）显示驱动芯片封测市场规模持续增长

未来全球范围内，从需求端来看，依然将有新增的面板产能释放，对于显示驱动芯片的需求持续走高；从供应端来看，晶圆代工厂虽然一直有新建产能投产，但多数都还未能实现量产，预计 2023 年晶圆产能才有望达到供需平衡。显示驱动芯片的产量不足，将持续推高销售价格，因此显示驱动芯片封测市场规模将也随之上涨，据 Frost & Sullivan 预计，在 2025 年将达到 56.10 亿美元。

未来随着国内芯片设计厂商的发展以及晶圆产能紧缺短期内难以改变的局
面，中国显示驱动芯片封测行业的需求将快速增长。据 Frost & Sullivan 预计，中国整体显示驱动封测市场规模将从 2021 年的 184.30 亿元增长至 2025 年的 280.80 亿元，年均复合增长率约为 11.10%，2025 年中国显示驱动封测市场占全球市场比重将提升至 77.01%。

综上所述，依托江苏汇成多年技术、人才、客户资源等积累，基于 12 吋产品的先发优势、领先的技术优势、知名客户的资源优势、政府的大力支持与显示驱动芯片市场的持续增长等因素叠加，公司在设立后短期内业务规模大幅增长。

3、发行人与江苏汇成在业务、技术、人员方面的关系及发展过程

根据发行人出具的说明并经本所律师访谈实际控制人，公司在显示驱动芯片封测领域深耕多年，自 2011 年江苏汇成设立以来，发行人与江苏汇成在业务、技术、人员方面的关系及发展过程如下：

项目	业务发展	技术发展	人员情况
关系	业务上独立发展，实现客户资源共享，发挥协同作用	汇成股份依托江苏汇成的技术积累自主研发，并与江苏汇成共享已有技术	核心管理人员与核心技术人员重合度较高，生产等部门人员独立
发展过程	2011 年-2015 年(初创期) 江苏汇成设立，以金凸块制造业务为基础拓展至显示驱动芯片封测领域	8 吋晶圆 Gold Bumping、CP、COG 与 COF 研发、试产并量产	中国台湾显示驱动芯片封测领域的专业技术人才与童剑峰、郑瑞俊、杨绍校等投资者共同设立江苏汇成

2015年-2018年(转型期)	①汇成有限设立,布局12吋晶圆封测产线并逐渐具备金凸块制程量产能力,通过江苏汇成导入老客户,不断开拓新客户; ②江苏汇成持续扩大8吋晶圆封测规模,持续开拓新客户。	①汇成有限完成12吋晶圆封测生产制程研发; ②江苏汇成持续优化生产工艺。	汇成股份与江苏汇成核心管理人员与核心技术人员重合度较高,生产、行政、采购等部门人员独立
2018年至今(快速发展期)	①汇成股份持续开拓新客户,12吋晶圆封测业务快速增长; ②江苏汇成业务稳定增长,汇成股份客户逐步释放8吋晶圆封测业务至江苏汇成。	汇成股份与江苏汇成根据客户需求与行业发展趋势持续优化已有技术并研发新技术,满足大尺寸晶圆、高密度细间距芯片封测要求	

(1) 2011年-2015年(初创期)

2011年,为迎合LCD面板制造行业产能向中国大陆转移的大趋势,一批中国台湾显示驱动芯片封测领域的专业技术人才,来到中国大陆寻求资金支持,与童剑峰、郑瑞俊、杨绍校等投资者达成合作,共同设立江苏汇成。

江苏汇成设立时,童剑峰由于曾任上市公司财务负责人、副总经理,具备丰富的企业管理经验,故出任江苏汇成董事长,总体负责江苏汇成的经营管理工作;中国台湾的技术与管理团队在显示驱动芯片封测领域,拥有丰富的技术研发与生产管理经验,故负责具体的技术研发、生产经营等事项;郑瑞俊、杨绍校及徐州午辰实业发展有限公司在江苏汇成设立初期均为财务投资人,未参与江苏汇成的实际经营管理。

2011年至2014年,江苏汇成投入大量资金购入金凸块制造等各制程的设备,搭建研发平台持续进行显示驱动芯片封测技术的开发,建设生产线以实现量产。然而,由于设备投入较大、研发周期与客户认证周期较长,江苏汇成在发展初期亏损严重,童剑峰等初始投资人陆续退出;同时,童剑峰辞去江苏汇成董事长职务。

郑瑞俊在中国大陆经商多年,通过瑞成建筑从事半导体无尘室建设过程中,于集成电路产业链中积累了丰富的人脉资源,对集成电路行业的发展有较为直观的感知与深刻的认识。由于看好显示驱动芯片封测行业的长期发展,为维持江苏汇成的持续经营,郑瑞俊逐渐参与公司经营管理,接任江苏汇成董事长并成为其实际控制人,继续筹集资金投入研发与生产,并积极吸引专业人才、开拓优质客户。

在郑瑞俊的管理下，江苏汇成于 2014 年实现 8 吋金凸块制造与后段封装制程量产，完成天钰、奇景光电等重要客户的导入，江苏汇成逐渐走向正轨。

（2）2015 年-2018 年（转型期）

2015 年，为迎合显示驱动芯片大尺寸晶圆封装的发展趋势，公司通过合肥市政府招商引资落户于合肥市综合保税区，积极布局 12 吋晶圆显示驱动芯片封测业务。

2015 年至 2018 年，公司依靠江苏汇成已有的核心技术与核心管理团队，以及持续引入的专业技术人才，积极研发 12 吋晶圆金凸块制造技术与芯片倒装封装技术，组织生产经营活动，并独立批量招聘生产、行政、采购等部门人员维持日常的生产运营；同时江苏汇成不断优化已有核心技术，研发新的封装工艺。对于研发出的技术，公司与江苏汇成通过共同的核心技术人员、技术团队交流等方式实现共享，2018 年公司与江苏汇成各制程生产良率均稳定在 99.90% 以上。

在这期间，公司完成 12 吋晶圆封测基地建设，打造出一支经验丰富、结构合理、优势互补的研发团队，具备 12 吋晶圆金凸块制程量产能力。同时，公司通过江苏汇成导入天钰、奇景光电等优质老客户，并积极开拓优质的新客户；江苏汇成持续扩大生产规模，开拓新客户。

（3）2018 年至今（快速发展期）

2018 年至今，公司与江苏汇成根据客户需求与行业发展趋势，在原有核心技术基础上持续投入人员和资金进行研发，不断优化已有技术并研发新技术，满足大尺寸晶圆、高密度细间距芯片封测要求，以保持技术指标先进性、不断突破生产良率极限。

在人员方面，汇成股份与江苏汇成核心管理人员与核心技术人员重合度较高。公司与江苏汇成总经理均为郑瑞俊，负责母子公司的整体战略规划与生产经营；马行天为汇成股份分管销售的副总经理，负责母子公司的整体销售规划；施周峰为汇成股份财务总监、董事会秘书，负责母子公司的整体财务计划及上市事项；公司核心技术人员为林文浩、钟玉玄、陈汉宗与许原诚，均拥有丰富的研发与管理经验，负责把控母子公司的研发方向。

在业务方面，汇成股份凭借 12 吋晶圆封测服务稳定的封测良率、生产一体化、交付及时性等获得了行业客户的广泛认可，并基于此逐步在江苏汇成导入联咏科技、集创北方等知名客户，上述客户逐步释放 8 吋晶圆封测业务至江苏汇成。同时，公司与江苏汇成均独立开展业务，持续开拓新客户。

4、未将江苏汇成作为上市主体的原因

根据发行人出具的说明并经本所律师访谈实际控制人，为契合安徽省与合肥市政府集成电路的产业布局，充分享受政策红利，发挥产业集群协同作用，迎合 12 吋大尺寸晶圆封测趋势，公司将汇成股份设置成上市主体。

（1）契合政府集成电路产业布局政策，充分享受政策红利

作为国家级科技创新型试点城市，合肥市政府制定了集成电路产业发展规划，并结合自身特色，提出了“芯屏器合”的产业发展战略。2015 年，合肥市新型显示产业已形成规模，但集成电路产业仍处于起步初期。合肥市引进国际知名企业合作设立晶圆代工厂，利用合肥市新型显示产业的协同效应，以显示驱动芯片为切入点，通过面板显示等终端市场带动芯片产业发展。

在此背景下，公司通过合肥市政府招商引资落户合肥市综合保税区，成为合肥市集成电路产业集群的一员。合肥市政府积极出台政策支持集成电路产业集群的发展，公司为充分享受政策红利，契合政府集成电路产业布局，将上市主体设置在合肥市。

（2）发挥产业集群协同作用

以汇成股份作为主体上市能够最大限度地发挥产业集群协同作用，为公司业务发展奠定扎实的基础。目前合肥的集成电路产业已初具规模，集聚集成电路全产业链企业 200 余家，产业规模快速壮大，集聚效应持续放大，是全国少数拥有从芯片设计、晶圆制造、封装测试到配套材料设备或产成品应用等全产业链的城市之一，公司上下游企业如晶合集成、京东方、维信诺等均落户合肥或建厂，因而公司深入产业集群之中，可以有效节省运输时间与成本，提高生产响应速度以加快产品交付，缩短供应链周期，有利于发挥集成电路产业集群的协同作用。

（3）迎合市场发展趋势

近年来，随着集成电路行业技术进步，12 吋晶圆厂持续增加、产能供应不断增长，更具经济效益的 12 吋晶圆逐渐替代较小尺寸晶圆，显示驱动芯片设计公司亦持续提高 12 吋晶圆产品比例，进而促进了 12 吋晶圆封测的需求。

为迎合液晶显示行业全面屏化的发展趋势，满足显示驱动领域大尺寸晶圆封装的要求，公司自 2015 年起积极布局 12 吋封装产品，在合肥设立新的主体建设 12 吋产线。考虑到 12 吋封装产品是公司未来重点发展方向，同时 12 吋晶圆凸块制造与封装技术更具先进性，因此将汇成股份设置为上市主体更符合科创板对技术先进性的要求。

（4）对人才吸引等可持续发展前景较好

合肥市作为“新一线城市”，对人才落户安家就业的吸引力较强，公司作为集成电路产业重要的一环，将上市主体设置在合肥市拥有较好的可持续发展前景。近年来，合肥市大力协同推进制造业转型升级，不断推进“制造”向“智造”转变，实现产业结构优化升级和生产力的整体跃升，具有中科大、晶合集成、京东方等知名高校和企业。作为国内集成电路产业发展最快、成效显著的城市之一，合肥市获批首批国家战略性新兴产业集群，是全国唯一的“海峡两岸集成电路产业合作试验区”，被国家发改委、工信部列为集成电路产业重点发展城市之一。

经核查，本所律师认为，公司未将江苏汇成作为上市主体是结合多方面因素考量后的结果，以汇成股份作为上市主体未来将更具优势和品牌效应。

（二）核心研发团队构成情况及背景，核心技术人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，发行人核心技术、产品的研发是否涉及其原任职单位的技术成果，是否存在纠纷及潜在诉讼风险

1、核心研发团队构成情况及背景

根据发行人提供的研发人员名单、核心技术人员出具的调查表，截至 2021 年 6 月 30 日，公司研发人员 185 名，占员工总数比例为 19.23%，研发人员中，本科及以上学历占比超过 50%。公司核心技术人员为林文浩、钟玉玄、许原诚、陈汉宗，均已在公司主营业务相关行业从业多年，具备相应的研发或管理经验。

2、核心技术人员是否存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的

情形

公司核心技术人员共 4 名，分别为林文浩、钟玉玄、许原诚、陈汉宗，根据核心技术人员出具的调查表，在其就职于发行人或其子公司江苏汇成之前，原任职单位如下：

序号	姓名	国籍/地区	入职汇成股份或江苏汇成之前 10 年的原任职单位及职务		原任职单位所在地
1	林文浩	中国台湾	2005 年 9 月至 2009 年 8 月	硕中科技（苏州）有限公司 工程部经理	江苏苏州
			2009 年 9 月至 2014 年 11 月	昆山龙腾光电股份有限公司 专案经理	江苏昆山
			2014 年 12 月至 2016 年 4 月	苏州顺惠有色金属制品有限公司 厂长	江苏苏州
			2016 年 4 月至 2016 年 8 月	丽智电子（昆山）有限公司 供应链处长	江苏昆山
2	钟玉玄	中国台湾	2003 年 3 月至 2006 年 9 月	华阳电子股份有限公司 协理	中国台湾
			2006 年 9 月至 2013 年 9 月	硕邦科技股份有限公司 生产部资深处长	中国台湾
3	许原诚	中国台湾	2002 年 5 月至 2008 年 6 月	米辑科技股份有限公司 黄光科科长	中国台湾
			2008 年 6 月至 2010 年 10 月	飞信半导体股份有限公司 黄光科副理	中国台湾
			2010 年 10 月至 2015 年 4 月	硕邦科技股份有限公司 专案副理	中国台湾
			2015 年 5 月至 2016 年 4 月	联立（徐州）半导体有限公司 制程经理	江苏徐州
4	陈汉宗	中国台湾	2003 年 6 月至 2011 年 10 月	硕邦科技股份有限公司 测试制造主任、产品工程主管	中国台湾
			2012 年 5 月至 2017 年 2 月	群雅电子股份有限公司 产品主管、制造经理	中国台湾
			2017 年 2 月至 2018 年 2 月	立卫科技股份有限公司 生产经理	中国台湾
			2018 年 3 月至 2019 年 11 月	东莞矽德半导体有限公司 研发副处长	广东东莞

根据中国台湾律师出具的法律意见书并经本所律师访谈核心技术人员、检索中国执行信息公开网、中国裁判文书网等网络公示信息，上述核心技术人员均不存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，具体分析如下：

（1）根据《中华人民共和国劳动合同法》第二十三条规定，对负有保密义务的劳动者，用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并约定在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。

第二十四条规定，在解除或者终止劳动合同后，竞业限制期限不得超过二年。因此，如果用人单位未在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款，并在解除或者终止劳动合同后，在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿，劳动者无需承担竞业限制义务。

（2）根据中国台湾地区关于竞业限制的相关规定，雇主未对劳工就竞业禁止限制支付合理补偿的，相关竞业禁止约定无效。

根据中国台湾律师出具的法律意见书：“钟玉玄、林文浩、许原诚、陈汉宗等四人自其中国台湾地区原雇主离职后至合肥新汇成微电子股份有限公司，纵使渠等有与原雇主签订竞业禁止条款，惟除非该竞业禁止限制条款范围明确、合理、必要，亦给予离职劳工合理补偿之代偿措施，在不影响离职劳工之就业权益前提下，始能够被中国台湾地区法院认定为有效条款，而被认定负有竞业禁止之限制，否则应为无效条款，不会获得法院支持。”

（3）林文浩、钟玉玄、许原诚、陈汉宗均已确认其未与原任职单位签署过竞业禁止、保密相关协议，未收到过原任职单位发放的竞业禁止、保密补偿金，未收到过原任职单位针对竞业禁止、保密事宜的权利主张，也未与原任职单位发生过与竞业禁止、保密相关的仲裁或诉讼。

经核查，本所律师认为，发行人核心技术人员均不存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形。

3、发行人核心技术、产品的研发是否涉及其原任职单位的技术成果，是否存在纠纷及潜在诉讼风险

《专利法》第六条规定，执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。《专利法实施细则》第十二条规定：“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：（一）在本职工作中作出的发明创造；（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所做出的发明创造；（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后 1 年内作出的，与其在原

单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”

根据发行人提供的核心技术清单、专利权证书、授予专利权通知书等文件，并经本所律师访谈相关部门负责人，发行人的核心技术涉及的主要专利均为发明人在发行人任职期间，利用发行人的物质技术条件、在履行发行人交办的工作中开发完成的，其权利属于发行人。发行人相关产品的技术来源不存在来自于相关人员在其他单位的职务发明，也不存在其他人以职务发明出资或转让等方式投入发行人的情形。

根据中国台湾律师出具的法律意见书并经本所律师检索中国执行信息公开网、中国裁判文书网等网络公示信息，截至本补充法律意见书出具之日，不存在发行人因知识产权侵权或其研发人员与前任职单位关于技术成果、职务发明侵权的争议或纠纷。

经核查，本所律师认为，发行人核心技术、产品的研发不涉及核心技术人员原任职单位的技术成果，不存在纠纷及潜在诉讼风险。

（三）核查情况

1、核查过程

针对上述事项，本所律师履行了如下核查程序：

- （1）获取发行人的核心技术清单，查阅发行人专利清单；
- （2）访谈核心技术人员，实地察看生产车间；
- （3）查阅发行人报告期各年度末员工花名册，对比汇成股份与江苏汇成人员情况；
- （4）查阅封测领域的行业研究报告及同行业公开披露信息；
- （5）获取发行人报告期内的销售明细表并访谈主要客户；
- （6）查阅发行人核心研发团队名单及简历、劳动合同、保密及竞业限制协议；
- （7）查阅核心技术人员填写的调查表、无犯罪记录证明；

（8）查验发行人的商标注册证、专利权证书、授予专利权通知书等文件，检索国家知识产权局商标局系统等网络公示信息；

（9）查阅发行人核心技术人员无犯罪记录证明及中国台湾律师出具的法律意见书，检索中国执行信息公开网、中国裁判文书网等网络公示信息。

2、核查意见

经核查，本所律师认为：

（1）发行人核心技术均为自主研发，来源合法合规；发行人在短期内业务规模快速增长具有合理性；发行人在业务方面与江苏汇成独立发展，客户资源共享，发挥协同作用，在技术方面依托江苏汇成的技术积累自主研发，在人员方面与江苏汇成核心管理人员、核心技术人员重合度较高，生产人员相对独立；发行人未将江苏汇成作为上市主体具有合理性。

（2）发行人核心研发团队具备相应的研发或管理背景，核心技术人员不存在违反原任职单位关于竞业禁止、保密协议约定的情形，发行人核心技术、产品的研发不涉及其原任职单位的技术成果，不存在纠纷及潜在诉讼风险。

三、【《问询函》问题 11】关于员工人数下降

根据申报材料，（1）2020 年度各个产品线的毛利率大幅提升，成本结构中人工成本占比大幅下降，均主要因为 2020 年开始员工人数与业务规模的反向变动所致。（2）报告期内发行人员工总人数分别为 998 人、1,128 人、918 人和 962 人。

请发行人说明：2020 年员工人数下降的原因，区分离职原因说明相关部门及其人数，与辞退福利的计提是否匹配，与业务发展情况、收入、产销量是否匹配，是否存在影响发行人稳定经营的情形，是否与发行人存在纠纷或潜在纠纷。

请保荐机构、发行人律师和申报会计师对上述事项进行核查并发表明确意见。

【回复】

（一）2020 年员工人数下降的原因，区分离职原因说明相关部门及其人数，与辞退福利的计提是否匹配，与业务发展情况、收入、产销量是否匹配，是否存在影响发行人稳定经营的情形，是否与发行人存在纠纷或潜在纠纷。

1、2020 年员工人数下降的原因

根据发行人出具的说明并经本所律师访谈人事部门负责人，公司 2020 年员工人数下降的主要原因如下：

（1）由于生产经营管理能力尚处于提升阶段，公司人员储备在 2018、2019 年大于实际需求

公司是国内较早投产的显示驱动芯片封装测试企业，公司设立之初集中于管理及技术研发工作，产线人员配置等各项生产管理环节尚处于磨合提升阶段。为此，公司早期储备了相对较多的人员，其中以生产人员为主，人员储备大于实际生产用工需求，因此 2018、2019 年用工人数相对较多。

（2）基于生产经营管理水平提升及经验曲线效应，为提高人员效率，公司自 2020 年起筹划人员优化

扬州生产基地自 2014 年实现量产后，公司发展重心向合肥生产基地的管理和技术研发工作倾斜，自 2017 年合肥生产基地投产后，基于经验曲线效应，公司生产经营管理水平处于逐步提升阶段，生产效率相应提升。同时，由于实际订单数量与前期预测存在一定偏差，导致生产人员储备有所冗余。为提高人员效率，公司自 2020 年起筹划人员优化，因此 2020 年起用工人数下降较多。

（3）叠加 2020 年 1 月起新冠疫情影响，较多非本地员工未返岗，进一步促进公司实施人员优化策略

受 2020 年 1 月起新冠疫情影响，公司较多非本地员工在春节后因无法及时返岗选择离职，进一步促进公司实施人员优化策略，当年度根据实际生产经营需求新招聘人员相对较少，导致当年度员工人数下降较多。

2、区分离职原因说明相关部门及其人数

根据发行人提供的 2020 年度各月员工花名册、抽样查看离职员工的劳动合同及离职相关文件并经本所律师访谈离职员工所属部门负责人，公司 2020 年度月均在职员工人数及变动情况如下：

时间	在职人数（人）	较上月变动人数（人）	变动比率
2019 年 12 月末	1,128	-	-
2020 年 1 月	1,103	-25	-2.22%
2020 年 2 月	1,069	-34	-3.08%
2020 年 3 月	1,020	-49	-4.58%
2020 年 4 月	956	-64	-6.27%
2020 年 5 月	919	-37	-3.87%
2020 年 6 月	881	-38	-4.13%
2020 年 7 月	868	-13	-1.48%
2020 年 8 月	877	9	1.04%
2020 年 9 月	888	11	1.25%
2020 年 10 月	906	18	2.03%
2020 年 11 月	922	16	1.77%
2020 年 12 月	923	1	0.11%

注：2020 年 1-12 月在职人数=（月初在职人数+月末在职人数）/2

经核查，公司 2020 年度员工人数下降主要集中在上半年度，下半年度员工人数相对维持稳定且有所回升，员工人数变动属于正常人员流动水平，故基于 2020 年 1-6 月的离职人员情况分析其所属部门及离职原因。

2020 年 1-6 月公司离职人员合计为 338 人（不含试用期内离职的员工），前述离职人员按部门及离职原因分类的情况如下：

离职人员类别	员工主动离职（人）	公司主动辞退（人）	小计（人）
生产人员	253	38	291
管理人员	17	9	26
研发人员	15	5	20
销售人员	0	1	1
合计	285	53	338

在离职员工所属部门方面，2020 年 1-6 月公司离职员工主要为生产人员；在离职原因方面，2020 年 1-6 月主要为员工主动辞职。存在前述情况主要系因生产人员中非本地员工占比较高，历年农历春节前后均为离职返乡的高峰期，2020 年春节叠加新冠疫情影响进一步加剧了该等情形；同时公司因实施人员优化策略相应减少了人员招聘，并主动辞退部分员工，因此 2020 年上半年度员工人数下降较多。

3、离职人员的去向、是否存在离职员工转移至关联方任职或关联方代垫成本费用情形

2020 年度，公司离职人员主要为一线生产人员，流动性相对较大，员工离职时公司未能获取其去向信息。针对是否存在离职员工转移至关联方任职或关联方代垫成本费用的情形，核查如下：

（1）核查实际控制人控制的其他企业用工情况

截至本补充法律意见书出具之日，除汇成股份外，实际控制人控制的其他企业情况如下：

序号	名称	主营业务
1	扬州新瑞连	对外投资
2	合肥芯成	发行人员工持股平台
3	合肥宝芯	发行人员工持股平台
4	合肥汇芯	发行人员工持股平台
5	香港宝信	发行人员工持股平台
6	汇成投资	对外投资
7	瑞成投资	对外投资
8	香港瑞仕	对外投资
9	瑞成建筑	建筑装饰工程
10	百瑞发投资	对外投资

除瑞成建筑存在业务经营并聘用员工外，实际控制人控制的其他企业均为投资性公司，无实际经营业务，未聘用员工或发放员工工资。报告期内，瑞成建筑每月领薪人数均不超过 40 人，而 2020 年公司离职员工人数超过 300 人，故不存在公司离职员工转移至瑞成建筑的情形；同时，瑞成建筑领薪人员与公司离职员工不存在重叠，不存在离职员工在瑞成建筑或实际控制人控制的其他企业继续任职或领薪的情形。

（2）核查公司食堂费用支出与员工人数下降的匹配情况

2019 年度公司食堂费用支出为 390.55 万元，2020 年度公司食堂费用支出为 303.75 万元，相较于 2019 年度均呈现显著下降，与 2020 年度员工人数的变化趋势一致。汇成股份及江苏汇成均采用食堂外包的形式，与供应商的单餐结算标准未下降，食堂费用支出的下降主要是用餐人数下降的变化所致，故公司食堂费用支出与员工人数下降情况基本匹配。

经核查，本所律师认为，公司不存在离职人员转移至实际控制人控制的关联企业任职的情形，亦不存在实际控制人控制的关联企业体外为公司代垫成本费用的情形。

4、与辞退福利的匹配情况

根据发行人提供的辞退福利明细并经本所律师访谈人事部门负责人，对于不能胜任岗位要求的员工，公司主动与之协商一致解除劳动关系，并根据《劳动合同法》的相关规定予以经济补偿，具体补偿金额根据员工入司时间、职级、前十二个月平均工资等参考因素与员工逐一协商确定。

2020年度，公司向55名被辞退员工支付辞退福利合计92.82万元，人均均为1.69万元，按2020年度公司员工月均工资0.72万元换算，即公司实际向被辞退员工支付辞退福利的平均标准（以下简称“实际支付标准”）为2.35个月工资。

根据《劳动合同法》的相关规定，公司辞退员工应根据员工在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向其支付经济补偿。上述55名被辞退员工按照前述规定平均应支付辞退福利的理论标准（以下简称“理论支付标准”）为2.31个月工资，实际支付标准与理论支付标准基本一致。

因此，公司辞退员工的人数与辞退福利基本匹配。

5、员工人数与业务发展情况、收入、产销量的匹配情况，是否存在影响发行人稳定经营的情形

根据发行人提供的报告期各期收入成本明细表、产销量统计表及其出具的说明，报告期内，公司各制程生产人员数量与主营业务收入、产量及销量的匹配情况如下：

	项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
Gold Bumping	主营业务收入（万元）	15,743.29	26,951.88	18,898.10	14,294.14
	产量（万片）	25.73	46.28	39.85	38.13
	销量（万片）	24.72	46.92	42.25	35.93
	生产人员（人）	139	138	167	168
	人均产出（万元/人）	226.52	195.30	113.16	85.08
	人均产量（片/人）	3,701.96	3,353.35	2,386.31	2,269.89
	人均销量（片/人）	3,556.31	3,400.03	2,529.94	2,138.78
CP	主营业务收入（万元）	8,273.71	12,151.01	6,732.71	4,627.74

	产量（万片）	21.94	36.34	26.41	28.08
	销量（万片）	20.76	37.02	28.85	26.24
	生产人员（人）	148	133	174	161
	人均产出（万元/人）	111.81	91.36	38.69	28.74
	人均产量（片/人）	2,964.51	2,732.08	1,517.87	1,744.04
	人均销量（片/人）	2,805.69	2,783.77	1,658.30	1,630.12
COG	主营业务收入（万元）	4,389.39	6,967.70	5,540.64	4,206.04
	产量（千颗）	319,102.14	605,679.10	546,647.24	509,149.17
	销量（千颗）	322,634.74	606,819.32	578,683.42	498,203.25
	生产人员（人）	188	177	220	212
	人均产出（万元/人）	46.70	39.37	25.18	19.84
	人均产量（千颗/人）	3,394.70	3,421.92	2,484.76	2,401.65
COF	主营业务收入（万元）	6,581.42	11,434.20	5,830.27	3,668.20
	产量（千颗）	138,691.82	215,476.62	128,974.57	79,027.87
	销量（千颗）	131,890.21	221,276.48	119,987.12	77,984.25
	生产人员（人）	201	216	267	195
	人均产出（万元/人）	65.49	52.94	21.84	18.81
	人均产量（千颗/人）	1,380.02	997.58	483.05	405.27
	人均销量（千颗/人）	1,312.34	1,024.43	449.39	399.92

注 1：人均产出=主营业务收入÷生产人员

注 2：人均产量=产量÷生产人员

注 3：人均销量=销量÷生产人员

注 4：为与其他年度可比，2021 年 1-6 月的人均产出、人均产量及人均销量均按年化处理

2018、2019 年，因公司生产经营管理能力尚处于提升阶段，存在人员储备大于实际需求的情形，人均产出、人均产量及人均销量波动较大，员工人数与收入、产销量的匹配度相对较弱。

基于经验曲线效应，报告期内公司生产经营管理水平逐步提升，生产效率相应提升，叠加自 2020 年起受新冠疫情及公司实施人员优化策略影响，2020 年上半年度公司员工人数下降较多，并于 2020 年中逐步趋于稳定，因此 2020 年度各制程人均产出、产销量内相较于 2018、2019 年均有较大提升。

2021 年 1-6 月金凸块制造、晶圆测试及玻璃覆晶封装制程的人均产出、产销量年化后与 2020 年度基本一致，薄膜覆晶封装制程的人均产出、产销量增速较快，主要系由于公司薄膜覆晶封装的业务增长明显，随着客户的持续导入以及订单的增长，该制程的人均产出、产销量均增长明显。

经核查，本所律师认为，公司报告期各期人均产出、产销量变化情况与公司业务发展情况相符，员工人数变动情况与业务发展、收入及产销量基本匹配，具

备合理性，公司 2020 年度员工人数下降未对其人均产出、产销量水平造成不利影响。同时公司离职人员主要为一线生产人员，核心团队持续稳定，不存在影响公司经营稳定性的情形。

6、是否与发行人存在纠纷或潜在纠纷

2020 年度员工离职主要系员工个人原因主动辞职及公司辞退员工。其中公司主动辞退的员工共 55 名，公司已按照与被辞退员工签署的书面解除协议约定或按照《劳动合同法》的相关规定向其支付了辞退福利。

根据合肥新站高新技术产业开发区人事劳动局、扬州市邗江区人力资源和社会保障局开具的合规证明并经本所律师访谈人事部门负责人，通过中国裁判文书网、中国审判流程信息公开网等网络平台对发行人劳动纠纷涉诉情况进行检索，截至本补充法律意见书出具之日，公司与 2020 年度离职员工不存在仲裁及诉讼情况，不存在纠纷或潜在纠纷。

（二）核查情况

1、核查过程

针对上述事项，本所律师履行了如下核查程序：

（1）查阅报告期各期发行人员工花名册及工资表，访谈发行人高级管理人员及人事部门负责人，了解 2020 年度员工人数下降较多的原因；

（2）获取并查阅发行人 2020 年度各月员工花名册，核查 2020 年度离职员工的所属部门及离职原因；访谈人事部门及离职员工所属部门负责人，核实辞退福利的确定标准及实际发放情况，确认与发行人是否存在纠纷或潜在纠纷；抽样查看离职员工的劳动合同及离职相关文件；

（3）查阅实际控制人控制的其他企业报告期内的财务报表及银行流水，查阅瑞成建筑的员工花名册、社保缴纳记录、员工工资单及薪酬发放的相应资金流水，核查实际控制人控制的其他企业聘用员工及发放薪资情况；查阅发行人 2019、2020 年度食堂费用支出统计表，核查是否存在发行人离职员工转移至实际控制人控制的其他企业或实际控制人控制的其他企业为发行人代垫成本费用的情形；

（4）查阅发行人辞退福利明细表，核查离职员工与辞退福利的匹配情况；查阅《劳动合同法》，了解关于辞退员工经济补偿的相关规定；

（5）查阅发行人报告期各期收入成本明细表及产销量统计表，分析各制程产销率变化情况及收入、产量与员工人数的匹配性；

（6）查阅发行人出具的关于员工离职情况及纠纷情况的说明，查阅发行人与被辞退员工就解除劳动合同事项签署的相关书面协议；查阅合肥新站高新技术产业开发区人事劳动局、扬州市邗江区人力资源和社会保障局开具的合规证明；通过中国裁判文书网、中国审判流程信息公开网等网络平台对发行人劳动纠纷涉诉情况进行检索。

2、核查意见

经核查，本所律师认为：

发行人 2020 年度离职员工人数与辞退福利的计提基本匹配；员工人数与业务发展情况、收入、产销量基本匹配，不存在影响发行人稳定经营的情形；发行人 2020 年度离职员工与发行人不存在纠纷或潜在纠纷。

四、【《问询函》问题 12】关于股权转让

根据申报材料：（1）杨绍校系汇成有限创始股东嘉兴高和的实际控制人，嘉兴高和曾于 2020 年 1 月向杨会转让部分股权以收回投资，转让价格为 3 元/注册资本。2020 年 12 月，杨绍校与语音基金签署可转债转让协议，约定语音基金将其对汇成有限 2,000 万元可转股债权及对应的转股权利转让给杨绍校，转让价格为 2,000 万元借款本金及相应利息，对应转股价格为 3 元/注册资本；（2）2020 年 3 月至 9 月，发行人股东扬州耕天下股权受让转让较为频繁，且交易价格存在较大差异（3 元至 5 元/注册资本不等）。其中，2020 年 5 月，黄俏瑜、林瑞琪夫妇有意通过其控制的扬州耕天下受让金海科贷持有的汇成有限全部股权系经郑瑞俊介绍；（3）杨绍校与发行人均参与江苏汇成设立初期。

请发行人说明：（1）杨绍校短期内转让及收购股权的原因、定价依据及合理性，并结合杨绍校对发行人的持股情况、控制创始股东嘉兴高和、参与江苏

汇成创始投资的情况，分析杨绍校与发行人实际控制人之间是否具有关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，是否存在潜在利益安排；

(2) 扬州耕天下增资及股权转让较为频繁的原因，交易定价依据及前后存在较大差异的合理性，是否存在利益输送及潜在利益安排。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

【回复】

(一) 杨绍校短期内转让及收购股权的原因、定价依据及合理性，并结合杨绍校对发行人的持股情况、控制创始股东嘉兴高和、参与江苏汇成创始投资的情况，分析杨绍校与发行人实际控制人之间是否具有关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，是否存在潜在利益安排

1、杨绍校短期内转让及收购股权的原因、定价依据及合理性

(1) 杨绍校控制的嘉兴高和出让股权的原因、定价依据及合理性

杨绍校系汇成有限及江苏汇成的创始股东之一，江苏汇成于 2011 年 8 月设立时，杨绍校即作为财务投资人通过汇旌投资间接投资于江苏汇成；汇成有限于 2015 年 12 月成立时，杨绍校控制的嘉兴高和系创始股东之一。

2018 年，杨绍校考虑到其投资江苏汇成及汇成有限的时间较长，拟退出汇成有限并回收投资。经与汇成有限实际控制人郑瑞俊、杨会夫妇协商，双方就嘉兴高和股权转让事项达成初步意向，拟由郑瑞俊夫妇受让嘉兴高和所持汇成有限股权。为此，郑瑞俊夫妇于 2018 年 8 月至 10 月期间向嘉兴高和、杨绍校及其控制的主体支付部分股权转让款。

随着我国于 2018 年 11 月宣布设立科创板，鼓励硬科技企业在科创板上市融资以及不断加大对集成电路行业的政策支持力度，杨绍校与郑瑞俊夫妇协商一致后，决定保留嘉兴高和持有的部分股权，并于 2019 年 7 月与郑瑞俊等相关主体签署书面协议，约定嘉兴高和将其持有的汇成有限 5.22% 股权（对应出资额 2,359.39 万元）转让给汇成投资、扬州新瑞连或其指定的第三方，转让价格为 3.00 元/注册资本。基于前述协议，嘉兴高和与杨会于 2020 年 1 月就股权转让事项签署书面协议，并相应办理股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让系转让双方真实意思表示，转让价格系参考汇成有限同期外部融资估值并经双方协商一致后确定，与汇成有限同期其他股权转让价格不存在显著差异，具备合理性。

（2）杨绍校通过债转股方式增资的原因、定价依据及合理性

语音基金于2019年8月28日与公司及相关方签署了可转债投资协议，约定语音基金有权在2023年9月1日前将其对公司的4,000万元债权转为对公司的增资款，增资价格为3.00元/注册资本；语音基金有权将该协议项下的可转股债权及对应的债转股权利转让给其指定第三方。2020年末，语音基金拟根据前述协议行使转股权利，为控制投资规模，仅计划行使2,000万元债权的转股权。

嘉兴高和于前述股权转让后，由于汇成有限进行多次股权融资，嘉兴高和在汇成有限的持股比例由13.28%被稀释到9.31%，杨绍校为维持其持股比例存在增持诉求。同时，杨绍校作为公司主要股东，对公司情况较为了解，且作为自然人交易效率较高，具有相应的投资能力，便于语音基金债权的快速收回，经各方协商，语音基金同意将其对公司的2,000万元债权及对应的债转股权利转让给杨绍校，转让价格为主债权2,000万元及主债权存续期间按年利率12%计算的利息。前述转让价格系参考可转债投资协议约定的债权价格上浮一定比例确定，杨绍校受让语音基金可转股债权的价格具有合理性。

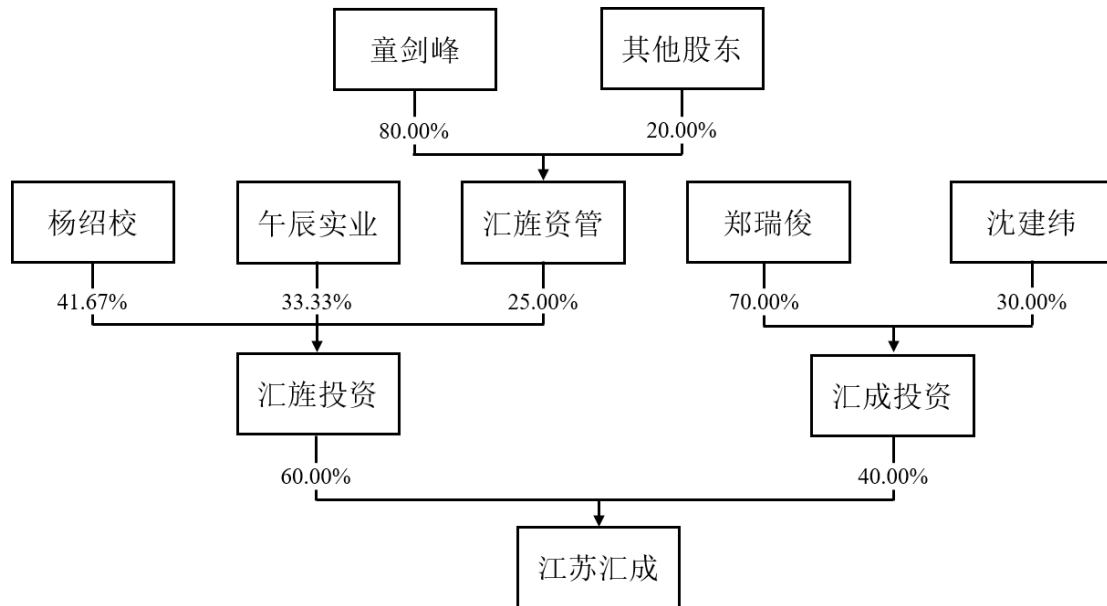
2020年12月9日，汇成有限召开股东会，决议通过：同意语音基金将其对公司2,000万元可转股债权及对应的债转股权利转让给杨绍校；同意语音基金、杨绍校分别以其享有的2,000万元债权对公司增资，增资价格为3.00元/注册资本，与可转债投资协议约定的转股价格一致。

经核查，本所律师认为，杨绍校短期内转让及收购股权均具备真实的商业背景，交易及定价合理。

2、结合杨绍校对发行人的持股情况、控制创始股东嘉兴高和、参与江苏汇成创始投资的情况，分析杨绍校与发行人实际控制人之间是否具有关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，是否存在潜在利益安排

（1）杨绍校参与江苏汇成创始投资的情况

江苏汇成系于 2011 年 8 月 29 日设立，其设立时的股东为汇旌投资、汇成投资，具体股权结构如下：



江苏汇成设立时，杨绍校与上海汇旌资产管理有限公司（以下简称“汇旌资管”）、徐州午辰实业发展有限公司（以下简称“午辰实业”）共同投资于汇旌投资，并通过汇旌投资间接持有江苏汇成股权。彼时江苏汇成的经营管理事务主要由汇旌资管主持，汇旌资管的实际控制人童剑峰担任江苏汇成董事长，总体负责江苏汇成的经营管理事项，具体技术研发、生产经营等事项由中国台湾籍管理团队负责；杨绍校、午辰实业及汇成投资在江苏汇成设立初期均为财务投资人，未参与江苏汇成的实际经营管理。

江苏汇成设立后，因经营管理不善导致持续亏损，汇旌资管于 2014 年 7 月将其所持全部汇旌投资股权转让给扬州新瑞连；同时，童剑峰辞去江苏汇成董事长职务，郑瑞俊接任江苏汇成董事长并在此后总体负责江苏汇成的经营管理。在此期间，杨绍校始终作为直接及间接持股的财务投资人，亦未参与江苏汇成实际经营管理。

（2）杨绍校对发行人的持股情况

为响应合肥市政府的招商引资政策，江苏汇成各股东按原股权架构于 2015 年 12 月设立汇成有限并全资收购江苏汇成，此后杨绍校通过嘉兴高和间接持有汇成有限的股权。

杨绍校在对发行人持股期间，仅作为财务投资人持有公司股权，未参与公司实际经营管理，其独立行使股东权利并作出投资决策，未与发行人实际控制人签署任何一致行动协议或实质上保持一致行动的情形。

（3）杨绍校控制初始股东嘉兴高和的情况

嘉兴高和自设立之日起一直系杨绍校及其妹妹杨绍会控制的合伙企业，与发行人实际控制人不存在关联关系或一致行动关系。

（4）杨绍校与发行人实际控制人之间不具有关联关系

发行人实际控制人郑瑞俊系中国台湾籍自然人，杨会系中国大陆籍自然人，杨绍校与郑瑞俊、杨会之间不存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的亲属关系或关联关系。

（5）杨绍校与发行人实际控制人之间不具有《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，不存在潜在利益安排

根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，杨绍校与发行人实际控制人不构成一致行动关系，具体分析如下：

《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款规定	具体分析	是否存在相关情形
（一）投资者之间有股权控制关系；	杨绍校与实际控制人均为自然人，不适用本条第（一）项至第（四）项规定的情形	不适用
（二）投资者受同一主体控制；		
（三）投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员；		
（四）投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响；		
（五）银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排；	杨绍校与实际控制人之间的资金往来均为股权转让相关款项，均不存在为对方取得发行人股份提供融资安排的情形	不存在
（六）投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系；	杨绍校与实际控制人存在共同投资汇旌投资、高投邦盛的情形，但不属于本项规定的情形，具体详见下文说明。	不存在
（七）持有投资者 30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份；	杨绍校与实际控制人均为自然人，不适用本条第（七）项至第（九）项规定的情形	不适用
（八）在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份；		
（九）持有投资者 30%以上股份的自然人和		

在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份；		
（十）在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份；	杨绍校与实际控制人之间不存在亲属关系	不存在
（十一）上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份；	杨绍校与实际控制人均为自然人，不适用本项规定的情形	不适用
（十二）投资者之间具有其他关联关系。	杨绍校与实际控制人不存在其他关联关系	不存在

就杨绍校与实际控制人不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条第（二）款第（六）项所列之情形分析如下：

①关于杨绍校与实际控制人共同投资于汇旌投资的分析

2011年8月，汇旌投资与汇成投资共同出资设立江苏汇成，杨绍校作为汇旌投资股东之一通过汇旌投资间接持有江苏汇成股权，郑瑞俊通过其控制的汇成投资间接持有江苏汇成股权。汇旌投资系杨绍校、汇旌资管及午辰实业为投资江苏汇成而设立的持股平台，其设立时实际控制人未直接或间接持有股权。

2014年7月至2015年1月期间，江苏汇成因经营管理不善持续亏损，汇旌资管、午辰实业相继退出，并将其持有的汇旌投资股权转让给实际控制人控制的扬州新瑞连。此后，杨绍校与扬州新瑞连各持有汇旌投资50%股权，直至2018年1月汇旌投资注销。汇旌投资并非实际控制人与杨绍校自始设立的共同投资平台，实际控制人系因扬州新瑞连受让汇旌投资退出股东的股权而被动形成与杨绍校共同投资汇旌投资的情形，同时杨绍校、扬州新瑞连在共同作为汇旌投资股东期间，根据汇旌投资公司章程的约定独立行使在汇旌投资的股东权利，在汇旌投资中不存在一致行动情形。因此杨绍校虽与实际控制人存在共同投资汇旌投资的情形，但不属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第（二）款第（六）项所述的“合伙、合作、联营等其他经济利益关系”，不构成一致行动关系。

②关于杨绍校与实际控制人共同投资于高投邦盛的分析

杨绍校与实际控制人均作为有限合伙人直接或间接投资于高投邦盛，系作为

财务投资人共同投资于私募基金，持股比例较低，且均独立行使合伙人权利，在高投邦盛中不存在一致行动情形，不属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第（二）款第（六）项所述的“合伙、合作、联营等其他经济利益关系”，不构成一致行动关系。

综上，杨绍校与实际控制人不存在除共同投资发行人及江苏汇成以外的合伙、合作、联营等其他经济利益关系，杨绍校与实际控制人共同投资于汇旌投资、高投邦盛的情形不属于《上市公司收购管理办法》第八十三条第（二）款第（六）项所列之情形，不因此构成一致行动关系。

（6）杨绍校已出具书面承诺确认其与发行人实际控制人之间不存在关联关系或一致行动关系

2021年9月28日，杨绍校出具了《关于不谋求实际控制权的承诺》，承诺如下：“本承诺人认可并尊重郑瑞俊、杨会在汇成股份自始的实际控制人地位，不对郑瑞俊、杨会在汇成股份经营发展中的实际控制地位提出异议；本承诺人作为公司的财务投资人，不直接参与汇成股份日常经营管理，自投资汇成股份并成为其股东之日起未曾通过任何形式谋求公司控制权；本承诺人承诺在持有公司股份期间，不通过任何方式单独或共同谋求对汇成股份的控制权，不通过协议、委托及其他任何安排与公司其他股东采取一致行动，不通过协议、委托及其他任何安排与公司其他股东扩大其所能够支配的在公司股东大会或董事会上的表决权。”

2022年1月12日，杨绍校出具了《关于不存在关联关系和一致行动关系的承诺函》，承诺如下：“本人及本人控制的嘉兴高和与汇成股份实际控制人之间不存在关联关系、亲属关系、一致行动关系或类似安排；作为公司股东期间按照《公司章程》的规定行使股东权利并承担股东义务；作为公司董事/委派监事期间独立行使相关职权和义务，亲自出席会议，并在汇成有限以及发行人股东（大）会、董事会、监事（会）审议相关议案时，独立行使表决权、独立投票，与郑瑞俊、杨会自始不存在任何潜在和现实的一致行动关系或潜在利益安排。”

经核查，本所律师认为，杨绍校与发行人实际控制人之间不具有关联关系，亦不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，不存在潜在利益安排。

（二）扬州耕天下增资及股权转让较为频繁的原因，交易定价依据及前后存

在较大差异的合理性，是否存在利益输送及潜在利益安排

扬州耕天下合伙人为林瑞琪及其配偶黄俏瑜。林瑞琪为中国台湾籍自然人，在中国大陆及中国台湾地区经商多年，存在一定的资金积累，具有对外投资的能力和意愿。

林瑞琪与郑瑞俊相识多年，在扬州耕天下入股公司前，因公司持续投入规模较大，资金需求较多，郑瑞俊以个人名义向其借款用于公司及个人周转。林瑞琪与郑瑞俊于 2018 年 8 月签署书面协议，约定林瑞琪向郑瑞俊提供借款 4,600 万元，借款期限三年，未来林瑞琪有权要求郑瑞俊偿还借款或按照合理价格认购公司股权，郑瑞俊自 2019 年 10 月起陆续向林瑞琪归还前述借款。

2019 年末，许帮林、上海享堃、金海科贷等公司股东（许帮林、上海享堃及其关联方自 2015 年起即通过扬州嘉慧投资于江苏汇成及汇成有限）因投资时间较长及自身资金需求，拟出让其持有的汇成有限股权。经郑瑞俊介绍，林瑞琪、黄俏瑜了解到前述股东的退出意愿后，通过扬州耕天下陆续受让前述股东持有的股权，由于各出让方转让股权的数量及价格要求不同，且系各方系分别协商定价，因此扬州耕天下受让前述股权的价格存在一定差异。扬州耕天下受让前述股权后，持有汇成有限 1,800 万元股权，取得前述股权的加权平均受让价格为 3.69 元/注册资本。

扬州耕天下因投资总额超出其预期投资金额，出于控制投资规模考虑拟降低持股比例，且考虑到其对公司的投资已于短期内实现增值，经与田林林协商一致，将其持有的汇成有限 0.57% 的股权（对应出资额 3,00 万元）转让给田林林，转让价格为 4.20 元/注册资本，系在公司最近一次增资价格（即志道投资于 2020 年 4 月以 4.50 元/注册资本的价格对公司增资）基础上给予一定折价。

经核查，本所律师认为，扬州耕天下历次股权转让均具备真实原因及背景，转让价格具有合理性，不存在利益输送及潜在利益安排。

（三）核查情况

1、核查过程

针对上述事项，本所律师履行了如下核查程序：

（1）查阅发行人及江苏汇成的工商档案材料、历次股权转让/增资协议、股权转让价款/增资款付款凭证；

（2）访谈相关股东，查阅相关股东就股权变动事项签署的相关协议及相应的资金流水，核查杨绍校、嘉兴高和及扬州耕天下历次股权变动的原因和背景；

（3）查阅语音基金相关的可转债投资协议、转让协议及相关股东会决议；

（4）查阅杨绍校出具的《关于不谋求实际控制权的承诺》、《关于不存在关联关系和一致行动关系的承诺函》；

（5）查阅《上市公司收购管理办法》。

2、核查意见

经核查，本所律师认为：

（1）杨绍校短期内转让及收购股权均具备真实的商业背景，交易及定价合理；杨绍校与发行人实际控制人之间不具有关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系，不存在潜在利益安排。

（2）扬州耕天下历次股权转让均具备真实原因及背景，转让价格具有合理性，不存在利益输送及潜在利益安排。

五、【《问询函》问题 13】关于国有股东事宜

根据保荐工作报告，2016 年发行人引入国有股东合肥创投，2018 年 10 月合肥创投与扬州新瑞连签订了股权转让协议并约定分四期支付股权转让款及利息。因汇成有限增资导致合肥创投在汇成有限持股比例降低未履行评估、备案程序。

请发行人结合相关法律规定，分析说明合肥创投的投资及后续股权转让是否履行完备的程序，汇成有限增资未履行评估、备案程序是否符合相关法律规定及国资管理的相关要求。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

【回复】

（一）结合相关法律规定，分析说明合肥创投的投资及后续股权转让是否履行完备的程序，汇成有限增资未履行评估、备案程序是否符合相关法律规定及国资管理的相关要求。

1、合肥创投的投资及后续股权转让是否履行完备的程序

（1）合肥创投投资汇成有限已履行完备的程序

2016年10月14日，汇成有限召开股东会，同意公司注册资本由26,164.02万元增至40,164.02万元，其中新增的8,000万元出资额由合肥创投以20,000万元认缴。同日，合肥创投与汇成有限其他股东及实际控制人郑瑞俊签署了投资协议，约定合肥创投认购汇成有限新增注册资本8,000万元，增资价格为2.50元/注册资本。

针对本次投资事宜，合肥创投委托中水致远资产评估有限公司于2016年8月15日出具《资产评估报告》（中水致远评报字[2016]第2513号），并就前述资产评估结果办理了国有资产评估备案手续。

2016年合肥创投以现金投资汇成有限已履行了必要的决策审批程序，未违反相关法律法规关于国有股权管理的规定。

（2）合肥创投后续股权转让已履行完备的程序

合肥创投投资入股时，与扬州新瑞连等汇成有限股东于2016年10月签署投资协议，约定汇成有限股东扬州新瑞连、嘉兴高和、高投邦盛、邦盛聚源有权自合肥创投增资完成之日（即2016年11月17日）起60个月内回购合肥创投持有的全部或部分汇成有限股权。经协商一致，扬州新瑞连于2018年10月决定行使前述回购权，受让合肥创投持有的汇成有限6,800万元股权，股权转让价格为2.50元/注册资本附加相应的利息。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国资委、财政部令第32号，以下简称“32号令”），国有及国有控股企业、国有实际控制企业的产权转让原则上通过产权市场公开进行，符合32号令规定情形的可以协议转让。但根据32号令第六十六条之规定，政府设立各类股权投资基金投资形成企业产

（股）权对外转让，按照有关法律法规规定执行，不适用 32 号令的前述规定。

合肥创投系合肥市政府投资引导基金，根据合肥市国资委当时下发的《合肥市创业投资引导基金管理办法》第十七条规定，引导基金通过股权协议转让（含回购，下同）方式退出的，可在投资协议中对转让方式、转让条件、转让价格、转让对象等事项进行约定，并报市国资委备案。引导基金退出时，投资协议对退出有约定的，按照协议约定退出；投资协议没有约定的，按照市场化方式和有关规定办理退出事宜。鉴于合肥创投已就投资入股汇成有限事宜报合肥市国资委备案，故合肥创投可以基于上述规定按照投资协议的约定进行转让。

2021 年 9 月 27 日，合肥市国资委出具《关于对合肥市创业投资引导基金有限公司投资合肥新汇成微电子股份有限公司相关事项予以确认的函》，确认合肥创投于 2018 年 10 月向扬州新瑞连转让其持有的汇成有限部分股权符合《合肥市创业投资引导基金管理办法》的规定，该次股权转让真实、合法、有效。

经核查，本所律师认为，合肥创投系合肥市政府投资引导基金，其协议转让持有的汇成有限股权符合《合肥市创业投资引导基金管理办法》等相关规定，且合肥市国资委亦书面确认该次转让真实、合法、有效，合肥创投投资汇成有限及后续股权转让均已履行完备的程序。

2、汇成有限增资未履行评估、备案程序是否符合相关法律规定及国资管理的相关要求

根据《企业国有资产评估管理暂行办法》等相关法规，非上市公司国有股东股权比例变动的，应当对相关资产进行评估，并对该资产评估项目进行备案。合肥创投入股后，汇成有限历次增资导致合肥创投股权比例发生变动时，未按照《企业国有资产评估管理暂行办法》等相关法规履行资产评估及备案程序。

2021 年 9 月 27 日，合肥市国资委出具《关于对合肥市创业投资引导基金有限公司投资合肥新汇成微电子股份有限公司相关事项予以确认的函》，因汇成有限增资导致合肥创投在汇成有限持股比例降低虽未履行评估、备案程序，但未造成国有资产流失，不存在国有股东利益受损的情况。

经核查，本所律师认为，合肥创投入股后，汇成有限历次增资虽未按照《企

业国有资产评估管理暂行办法》等相关法规履行资产评估及备案程序，但有权国资主管部门已确认未造成国有资产流失，不存在国有股东利益受损的情况，因此该等情形不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

（二）核查情况

1、核查过程

针对上述事项，本所律师履行了如下核查程序：

（1）查阅发行人的工商档案材料、合肥创投投资汇成有限时签署的投资协议、中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》及相关国有资产评估备案文件；

（2）查阅合肥创投向扬州新瑞连转让股权的相关协议、股权转让价款的支付凭证；

（3）查阅《企业国有资产交易监督管理办法》《合肥市创业投资引导基金管理办法》《企业国有资产评估管理暂行办法》等相关法律法规；

（4）查阅合肥市国资委出具的《关于对合肥市创业投资引导基金有限公司投资合肥新汇成微电子股份有限公司相关事项予以确认的函》等书面确认文件。

2、核查意见

经核查，本所律师认为：

（1）合肥创投的投资及后续股权转让已履行完备的程序。

（2）合肥创投入股后，汇成有限历次增资虽未按照相关法规履行资产评估及备案程序，但有权国资主管部门已确认未造成国有资产流失，不存在国有股东利益受损的情况，因此该等情形不构成本次发行上市的实质性法律障碍。

六、【《问询函》问题 15.1】关于其他

公司是集成电路封装测试服务商，具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试能力，募集资金主要用于 12 吋显示驱动芯片封测扩能项目。

请发行人结合报告期内产能利用率情况，说明募投项目拟扩产能是否具备足够的市场消化能力，并说明对于现有项目及募投项目是否已履行完备的审批程序。

请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。

【回复】

（一）结合报告期内产能利用率情况，说明募投项目拟扩产能是否具备足够的市场消化能力

根据发行人出具的说明并经本所律师查询同行业可比公司公开披露文件，公司募投项目拟扩产能具备足够的市场消化能力。2021年1-6月，公司8吋晶圆金凸块制造制程产能利用率水平已高于同行业平均水平，12吋晶圆金凸块制造制程扩产符合行业发展趋势，晶圆测试制程产能利用率已高达93.16%，玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装制程产能利用率均在80.00%左右，目前公司整体产能较为紧张，亟需扩产。公司所属行业受国家政策鼓励支持，具有较好的市场前景，稳定的客户为公司带来了持续增长的订单，同时公司亦制定了一系列配套措施来保障募投产能的顺利消化。

1、公司整体产能较为紧张，亟需扩产

公司报告期内分工艺制程的产能利用率情况如下：

项目		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度	
Gold Bumping	8吋	产能（万片）	22.19	45.26	47.94	46.75
		产量（万片）	17.63	36.38	35.23	36.51
		产能利用率	79.45%	80.38%	73.49%	78.10%
	12吋	产能（万片）	9.90	19.79	14.30	8.25
		产量（万片）	8.10	9.90	4.62	1.63
		产能利用率	81.82%	50.03%	32.31%	19.76%
CP	额定工时（h）	501,486.00	862,436.40	567,142.32	403,340.16	
	实际工时（h）	467,195.56	659,187.23	414,995.96	370,215.06	
	产能利用率	93.16%	76.43%	73.17%	91.79%	
COG	产能（千颗）	420,076.21	891,849.92	817,537.20	659,979.10	

	产量（千颗）	319,102.14	605,679.10	546,647.24	509,149.17
	产能利用率	75.96%	67.91%	66.87%	77.15%
COF	产能（千颗）	166,377.13	295,981.68	205,056.48	98,819.66
	产量（千颗）	138,691.82	215,476.62	128,974.57	79,027.87
	产能利用率	83.36%	72.80%	62.90%	79.97%

注 1：制程 i 年度产能= \sum （第 j 月（日工作时间 \div 设备 k 标准产出时间 \times 设备 k 标准产出数量 \times 设备 k 利用率 \times 月工作日），i 属于 I，I 包括 Gold Bumping、COG、COF 等主要制程；j=1, 2, 3.....12；公司各制程产能由各设备协同作用决定，k 为制程 i 重要生产设备；
 注 2：额定工时= \sum （i 月末测试机数量 \times 设备利用率 \times 24 小时 \times 当月工作天数），i=1,2,3...12；
 注 3：制程 i 当期产能利用率=产量 / 产能，CP 当期产能利用率=实际工时 / 额定工时；
 注 4：当期产销率=销量 / 产量。

公司 8 吋与 12 吋晶圆金凸块制造制程的产能利用率 2021 年 1-6 月整体均在 80.00% 左右。根据南茂科技 2020 年年报披露，中国台湾各家从事 LCD 驱动 IC 芯片封测的公司，其 8 吋晶圆金凸块业务的产能利用率在 70% 左右，同时由于驱动 IC 设计日益复杂，12 吋晶圆金凸块业务产能为各家封测厂商扩产重点。公司 8 吋晶圆金凸块制造的产能利用率已高于行业产能利用率水平，12 吋晶圆金凸块制造扩产符合行业发展趋势。

公司晶圆测试制程的产能利用率在 2021 年 1-6 月已高达 93.16%，产能较为紧张，主要系公司业务快速扩张，晶圆测试制程的产能增加需要持续投入测试机台，受限于资金等因素，产量增长速度高于产能提升速度所致。

公司玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装制程的产能利用率变化趋势基本一致。2018 年度，合肥生产基地产能、产量较小，扬州生产基地贡献了较大份额的产能、产量，而且扬州生产基地发展时间较长、产能利用率较高，故公司整体产能利用率较高；2019 年度，随着生产设备的持续购入，公司玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装的产能得到显著提升，故产能利用率有所下降；2020 年度至 2021 年 1-6 月，公司大力拓展业务，产量上升较快，故产能利用率逐渐提升至较高水平。

综上所述，公司目前整体产能较为紧张，亟需扩产。

2、公司所处行业为中国战略新兴行业，进口替代需求持续上升

经本所律师查阅行业相关产业政策、行业研究报告、同行业可比公司年报等，公司所属集成电路行业作为国家战略新兴行业，政府出台政策大力扶持，积极引导该领域内的国产替代和自主可控。集成电路封测作为集成电路产业链中重要的

一环，未来发展前景广阔，尤其是随着中国大陆显示面板行业的蓬勃发展，产业链中的封测环节进口替代需求持续上升。

因此，公司扩充产能符合国家政策，有效提升集成电路国产化率与自主可控程度。

3、显示驱动芯片出货量持续增长，12 吋晶圆市场需求稳定上升

根据发行人出具的说明并经本所律师查阅行业相关产业政策、行业研究报告，显示驱动芯片封测与显示驱动芯片呈同比增长关系，根据 Frost & Sullivan 预测，未来随着显示技术的升级与下游应用的拓展将推动显示驱动芯片市场的进一步增长，进而带动显示驱动芯片封测需求上升。

综合考虑行业趋势与经济效益，显示驱动芯片设计公司不断提高 12 吋晶圆产品比例，进而促进了 12 吋晶圆封测的需求。公司根据行业发展前景和市场需求，进行“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”建设，有助于满足下游市场需求，有助于形成规模化生产能力。

4、公司与客户较强的粘性带来稳定增长的订单

根据发行人出具的说明并经本所律师访谈主要客户、公司高级管理人员与销售部门负责人，显示驱动芯片的封装测试厂商需要经过芯片设计公司较长时间的工艺认可，而后才能达成长期合作意向，故存在较高的供应链门槛。在该合作模式下，客户更换封测供应商的成本较高，双方合作关系较为稳定。

自成立以来，公司凭借自身优势，与联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电、晶门半导体等行业内知名芯片设计公司建立了稳定的合作关系。在中国大陆显示面板行业蓬勃发展的背景下，深厚的客户资源将为公司带来持续增长的生产订单。

5、公司已制定一系列配套措施来保障募投产能的顺利消化

根据发行人出具的说明并经本所律师访谈公司高级管理人员，针对该扩产项目，公司已制定一系列措施用于消化未来新增产能，主要包括：

(1) 持续加大研发投入，提升公司产品的各项标准以满足集成电路行业快

速迭代发展的需求

集成电路芯片封装测试及显示驱动芯片封装测试的市场前景广阔，技术研发能力是公司不断扩大市场份额、消化新增产能的基础。公司将在现有技术基础上，持续加强研发投入，培养研发队伍，引入优秀人才，在生产工艺和生产装置的先进性上持续进行发明和创新，保持公司在显示驱动芯片封装测试领域的技术优势，满足集成电路行业快速行业迭代发展的需求。

（2）持续跟踪服务现有客户，深度绑定行业内主要晶圆设计厂商及代工厂商，强化与其合作深度

公司及子公司从事显示驱动芯片封测多年，已积累了包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电、晶门半导体等行业内知名芯片设计公司在内的多家客户资源，并与其形成了稳定的合作关系。未来公司将持续跟踪服务现有客户，以现有技术方案为基础，紧密跟踪终端客户的需求，凭借研发实力、产品质量、响应速度、服务水平等，持续增强客户粘性，为未来新增产能建立市场与客户基础。

（3）壮大营销服务队伍，完善考核激励制度

公司将继续加强营销服务队伍建设，积极引进具备集成电路、封装测试等学历背景、熟悉行业现状和发展趋势、具备快速拓展市场的人才。公司将做好市场规划及分析，在销售技巧、售后服务技能等方面展开有效的培训，提高销售、售后队伍的综合素质，打造一支既懂公司产品技术又具有丰富市场拓展经验的复合型销售队伍。公司还将进一步完善营销分配机制与激励机制，将销售业绩与总体考核指标挂钩，持续提升一线销售人员的积极性。

综上所述，公司整体产能利用率较为紧张，扩产需求较为强烈，所属行业受国家政策鼓励支持，具有较好的市场前景；稳定的客户为公司带来了持续增长的订单，同时公司制定了一系列配套措施来保障募投产能的顺利消化。因此，公司募投项目拟扩产能具备足够的市场消化能力。

（二）说明对于现有项目及募投项目是否已履行完备的审批程序

公司主要从事显示驱动芯片封测业务，项目审批程序主要为项目备案或项目核准，以及环评批复等。根据发行人提供的已建项目及募投项目的可行性研究报告

告、环评批复及项目备案或核准文件等资料，公司现有项目及募投项目均已履行完备的审批程序，具体情况如下：

公司现有项目主要为扬州生产基地与合肥生产基地的建设，所涉及的项目均已按照规定履行了完备的审批程序，取得项目备案或核准文件，以及环评批复等资料。具体如下：

序号	项目名称	项目备案号/备案许可文件号/项目核准文件号	环评批复文号
1	晶圆凸块封装、测试项目（一期）	合综试经（2016）27号	环建审（2017）85号
2	晶圆凸块封装、测试生产厂房工程项目		环建审（新）字（2016）83号
3	LCD 驱动 IC 封测生产线技术改造项目	2017-321003-39-03-635475	扬邗环审（2018）52号
4	LCD 驱动 IC 封装测试项目	扬邗发改投（2011）78号、扬邗发改投（2012）4号、扬邗发改投（2012）7号	扬环审批（2012）2号

关于募投项目，公司已完成“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”的项目备案并取得环评批复；已完成“研发中心建设项目”的项目备案，根据合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局出具的情况说明，“研发中心建设项目”无需办理环境影响评价手续；补充流动资金项目不涉及生产活动，不会对环境造成重大影响。

公司“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”系在公司现有场地进行，只需新建或装修无尘室，补充流动资金项目不涉及用地事项。具体如下：

序号	项目名称	项目备案号	环评批复文号
1	12吋显示驱动芯片封测扩能项目	2106-340163-04-05-868647	环建审（2021）12034号
2	研发中心建设项目	2106-340163-04-05-926481	无需环评
3	补充流动资金	不涉及	不涉及

合肥新站高新技术产业开发区系安徽省省级开发区，经贸发展局为开发区投资主管部门，受市级委托行使相关权限，负责合肥新站高新技术产业开发区固定投资项目（包含技术改造项目）的核准、备案工作，上级主管部门为合肥市发改委，上述职权来源于合肥市发改委的授权。

公司已取得合肥新站高新技术产业开发区经贸发展局出具的书面确认文件：

公司现有项目及募投项目均按相关规定履行了完备的审批程序，符合法律法规的要求。

经核查，本所律师认为，公司对于现有项目及募投项目已履行完备的审批程序。

（三）核查情况

1、核查过程

针对上述事项，本所律师履行了如下核查程序：

- （1）取得发行人各期生产资料；
- （2）查询发行人同行业可比上市公司年度报告等公开披露资料；
- （3）查阅行业相关产业政策、行业研究报告、公司年报等；
- （4）访谈发行人主要客户，查阅发行人收入明细表、主要客户销售合同等资料；
- （5）访谈发行人高级管理人员与销售部门负责人。
- （6）查阅发行人已建项目及募投项目的可行性研究报告、环评及备案或核准文件等资料；
- （7）访谈合肥新站高新技术产业开发区经贸发展局，取得并查阅其出具的书面确认文件；
- （8）登陆安徽省投资项目在线审批监管平台（<http://tzxm.ahzfwf.gov.cn/index.jsp>）进行查询。

2、核查意见

经核查，本所律师认为：

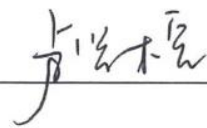
- （1）发行人募投项目拟扩产能具备足够的市场消化能力。
- （2）发行人对于现有项目及募投项目均已履行完备的审批程序。

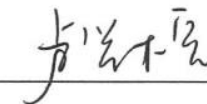
（以下无正文）

[本页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并上市之补充法律意见书（一）》签署页]

本补充法律意见书于 2022 年 1 月 24 日在安徽省合肥市签字盖章。
本补充法律意见书正本四份，无副本。



负责人：卢贤榕 

经办律师：卢贤榕 

陈磊 

孙静 